股票代碼：7828

創新服務股份有限公司
Innostar Service, Inc.

民國一一四年度年報

中 華 民 國 一一五 年 五 月 六 日　刊 印

本公司網站查詢年報網址：https://www.inno-stars.com/

公開資訊觀測站查詢年報網址：http://mops.twse.com.tw

一、公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：林俊忠

職稱：業務副總

電話：04-2680-1023

電子郵件信箱：ir@inno-stars.com

代理發言人姓名：張琪琪

職稱：財務協理

電話：04-2680-1023

電子郵件信箱：ir@inno-stars.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：新竹縣竹北市環北路一段 283 號 2 樓

電　　話：04-2680-1023

分 公 司：無

工　　廠：台中市大甲區大安港路 116 巷 10 號

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區重慶南路 1 段 2 號 5 樓

網址：http://www.kgi.com.tw

電話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：李典易會計師、鄭雅慧會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網 址：http://pwc.com.tw

電 話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：https://www.inno-stars.com/

年報目錄

頁次

壹、致股東報告書 1

貳、公司治理報告 4

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 11
三、公司治理運作情形 16
四、簽證會計師公費資訊 43
五、更換會計師資訊 44
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 45
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 45
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 46
九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 46

參、募資情形 48

一、資本及股份 48
二、公司債辦理情形 50
三、特別股辦理情形 50
四、海外存託憑證辦理情形 50
五、員工認股權憑證辦理情形 50
六、限制員工權利新股辦理情形 51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 51
八、資金運用計劃執行情形 51

肆、營運概況 55

一、業務內容 55
二、市場及產銷概況 77
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 86
四、環保支出資訊 86
五、勞資關係 86
六、資通安全管理 87
七、重要契約 89

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項 90

一、財務狀況 90
二、財務績效 91
三、現金流量 91

四、最近年度(114 年度)重大資本支出對財務業務之影響 92
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 92
六、風險事項之分析評估 93
七、其他重要事項 96
陸、特別記載事項 97
一、最近年度關係企業相關資料 97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價券辦理情形 98
三、其他必要補充說明事項 98
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 98

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位蒞臨參加本公司股東常會，謹代表創新服務股份有限公司表示誠摯的歡迎。以下報告本公司民國 114 年度營業結果及 115 年度營業計畫。

一、經營方針與經營績效概述

民國 114 年是創新服務股份有限公司營運跨越成長、獲利大幅躍升的關鍵里程碑。受惠於全球人工智慧（AI）算力爆發及高效能運算（HPC）晶片技術演進，半導體產業對測試精度與產能效率的要求日益嚴苛。本公司憑藉在 MEMS 探針卡自動化設備及先進封裝導通技術的深厚基礎，成功將研發能量轉化為營運實績，推動整體規模實現跳躍式增長。

在資本市場接軌方面，本公司股票上櫃申請案已正式獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審核通過，預計將於民國 115 年第二季正式掛牌上櫃。這不僅象徵公司治理與財務透明度獲得高度肯定，也開啟了本公司進入資本市場的新頁。此外，為支撐中長期訂單增長及研發佈局，公司於 114 年 8 月購置大甲區土地廠房，規劃作為營運總部及生產基地，確保產能供給無虞。

二、114 年度營運成果報告

(一)經營計畫實施成果

1. 國際策略結盟與市場拓展：本年度成功引進國際探針卡龍頭大廠 Technoprobe S.p.A. 進行策略性投資並取得一席董事席次。透過戰略合作，本公司不僅取得其在台灣及中國地區之材料包及專用設備銷售權，更進一步鞏固在全球半導體測試鏈中的競爭地位。
2. 產銷實績與規模化：研發之「Dual Arm MEMS 探針卡自動植針機」已穩定導入全球前五大探針卡製造商及指標客戶。隨設備出貨量增加，營運規模效應顯現，帶動本年度獲利大幅增長。

(二)預算執行情形：

本公司民國 114 年度未對外公開財務預測，然就內部營運目標執行概況而言，年度營業收入、營業利益及純益等各項指標，均隨半導體測試設備市場之強勁需求，達成原定經營計畫目標。整體預算執行情形良好，獲利結構亦趨於穩健。

(三)財務收支與獲利能力分析

本年度受惠於設備出貨規模經濟顯現，展現強勁獲利動能，各項財務指標如下：

1. 營業收入：合併營業收入為 716,233 千元。
2. 獲利表現：實現營業利益 278,325 千元；歸屬於母公司業主之本期淨利達 227,671 千元。

3. 每股盈餘 (EPS)：基本每股盈餘達到 6.33 元。

4. 資產總額：隨營運獲利累積與資產購置，總資產增至 1,742,594 千元。

(四)研究發展狀況

本年度研發費用投入達 154,341 千元，重點深耕「探針卡自動化整線解決方案」與「先進封裝銅柱技術」：

1. MEMS 探針卡自動化設備（核心技術升級）公司已完成從製造到維修的整線自動化設備開發，大幅提升競爭力：
   (1) Dual Arm 自動植針設備：推出雙臂（Dual Arm）高效 MEMS 探針卡自動植針機，大幅提升植針效率。
   (2) 全自動化維修整線設備：開發出完整的維修解決方案，包含自動雷射清潔、自動雷射塑針、自動維修換針、IPQC 自動檢測等全方位設備，強化一站式服務競爭力。
   (3) 關鍵製程設備：開發出 MEMS 探針卡雷射鑽孔設備、探針自動篩選整列設備。
2. 先進封裝與銅柱技術（新利基產品） 針對先進封裝需求，成功推出多款應用於 AI 伺服器電源銅柱導通模組以及 AI 高速傳輸晶片 3D 封裝的銅柱玻璃基板產品：
   (1) 高密度銅柱端子模組：
      A. Power Module：推出高寬深比銅柱電源模組，應用於 AI 伺服器電源管理。
      B. 天線模組：推出先進封裝銅柱天線模組(AiP) ，應用於低軌衛星陣列天線產品。
      C. TGV-ICP 技術：開發出先進封裝 TGV-ICP（玻璃通孔銅柱）基板技術，並已於第四季完成開發送樣。

回顧民國 114 年，本公司全體同仁辛勤努力，從順利完成興櫃申請並在興櫃市場展現穩健表現起，進而成功通過上櫃審核、邁向上櫃之路，無論在技術開發、獲利績效及公司治理上，皆交出了具代表性的成果。創新服務始終堅持以技術為本、以誠信為基，將研發成果切實轉化為經營績效，為股東創造價值。

三、115 年度重要產銷政策與研發進度

(一)生產與產能規劃（雙廠區分工）

為因應上櫃後之業務擴張與不同產品線之特性，本公司重新配置產能機能，以求營運效能最大化：

1. 大甲新廠：預計 115 年上半年完成廠房建置。該廠區規劃為「自動化設備組裝」與「先進封裝產品」生產基地，專責核心設備製造與前瞻封裝技術銅柱產品之規模化生產任務。
2. 竹北廠：規劃為「MEMS 探針卡自動化維修代工服務」專屬廠區，專注於台灣地區探針卡廠之維修需求，提供客戶快速回廠（Turnaround Time）與高效率代工返修之代工服務。

(二)先進封裝與新利基產品：加速量產驗證

本公司全力推進高成長性產品之開發時程，確保領先技術能迅速轉化為實質營收：

1. 銅柱 TGV（玻璃通孔技術）基板：鎖定 AI 伺服器與高效能運算需求，115 年將緊盯已送樣客戶之驗證反饋，動態優化設計與製程參數，力求盡速達成客戶規範並切入量產規模。
2. 高密度銅柱端子模組（Cu Pillar Module）：深化與先進封裝大廠之合作，開發次世代通訊及電源管理專用規格，加速可靠度驗證進度，爭取於 115 年下半年取得量產訂單。

四、未來發展策略與環境影響

(一)未來發展策略：服務化與技術多元化

本公司將透過竹北廠之「維修代工服務」建立深層技術對接，收集第一線數據回饋研發端以精進設備效能。同時，透過大甲新廠量產高密度銅柱端子模組（Cu Pillar Module）及 銅柱 TGV （玻璃通孔技術）基板等前瞻技術，全面卡位次世代 AI 晶片封裝載板之關鍵商機，實現技術與營收的多角化發展。

(二)外部競爭、法律及營運環境影響

1. 法規遵循：本公司已建立完善之內控制度與法人溝通渠道，確保掛牌後符合證券交易各項法規，落實公司治理以保障股東權益。
2. 風險管理：針對半導體產業循環波動，本公司透過 MEMS 探針卡之「關鍵銷售」與「代工服務」之穩定收入建立緩衝機制，大幅提升營運韌性與財務穩健度。

感謝各位股東對創新公司的支持、信任及愛護！

敬祝各位股東身體健康，萬事如意。

創新服務股份有限公司

董事長兼總經理：吳智孟

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

1.董事及監察人

115 年 4 月 30 日 ；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	吳智孟	男 51-60	105.5.27	114.6.27	3年	923,250	2.54	1,068,000	2.64	377,000	0.93	2,711,244	6.7	中央大學機械所碩士 中強光電(股)公司研發部處長 天瀚科技(股)公司研發部處長 揚明光學(股)公司研發部處長	本公司董事長兼總經理 上海創崴醫療器械有限公司董事長 Vision Wealth Global Co., Ltd.代表人	新產品事業處特助	吳政忠	二親等	—
董事	中華民國	力晶創新投資控股(股)公司	—	113.1.18	114.6.27	3年	2,675,000	7.37	2,675,000	6.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		謝明霖	男 51-60	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	臺灣大學商學研究所碩士 力晶創新投資控股(股)公司總經理 力晶科技(股)公司總經理特別助理 力晶科技(股)公司副總經理 力晶積成電子製造(股)公司副總經理	註 1	—	—	—	—
董事	中華民國	銳邑科技(股)公司	—	105.5.27	114.6.27	3年	3,382,813	9.32	3,382,813	8.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		黃俊祥	男 51-60	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	萬能科技大學計算機系學士 銳邑科技(股)公司董事長暨總經理	銳邑科技(股)公司董事長暨總經理	—	—	—	—
董事	中華民國	佶元投資(股)公司	—	105.5.27	114.6.27	3年	1,031,536	2.84	1,031,536	2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		溫士昆	男 51-60	—	—		—	—	—	—	—	—	1,416,942	3.5	臺灣科技大學機械系學士 敬東科技(股)公司董事長 躍昌科技(股)公司董事長 昆山群岱精密機械有限公司董事長 富啟投資有限公司董事長 佶元投資(股)公司董事長	敬東科技(股)公司董事長 躍昌科技(股)公司董事長 昆山群岱精密機械有限公司董事長 富啟投資有限公司董事長 佶元投資(股)公司董事長	—	—	—	—
董事	中華民國	展成技研有限公司	—	109.12.17	114.6.27	3年	634,000	1.75	634,000	1.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		鄭添乾	男 41-50	—	—		373,907	1.03	374,907	0.93	—	—	—	—	臺灣大學電機系碩士 創捷科技(股)公司董事長	創捷科技(股)公司董事長 展成技研有限公司董事長	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
															展成技研有限公司董事長 展育科技(股)公司董事長 威杰科技有限公司董事長	展育科技(股)公司董事長 威杰科技有限公司董事長				
董事	義大利	Technoprobe S.p.A.	—	114.2.11	114.6.27	3年	3,400,000	9.37	3,400,000	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	新加坡	HELLEN KEE	女 41-50-	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	都柏林大學市場行銷（榮譽）學士 Technoprobe Taiwan Co., LTD. 亞太區業務副總 Technoprobe Taiwan Co., LTD. 台灣總經理	Technoprobe Taiwan Co., LTD. 亞太區業務副總 Technoprobe Taiwan Co., LTD. 臺灣總經理	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	沈維民	男 61-70	114.6.27	114.6.27	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國 Purdue University 會計學博士 國立臺中科技大學財政稅務系教授 東海大學會計系副教授	晶豪科技(股)公司獨立董事 富采控股(股)公司獨立董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	張懿云	女 61-70	114.6.27	114.6.27	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	德國慕尼黑大學法學博士 輔仁大學財經法律系教授 經濟部智慧局法律諮詢顧問 交通部訴願審議委員會委員 教育部公費留學審議會委員	永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 大洋塑膠工業(股)公司獨立董事 大東樹脂化學(股)公司董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	顏志達	男 51-60	114.6.27	114.6.27	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	政治大學財政學系博士 臺中科技大學財政稅務系副教授	漢磊科技(股)公司獨立董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	林焜尉	男 61-70	114.6.27	114.6.27	3年	—	—	2,000	0	5,000	0.01	—	—	交通大學光電工程博士 凌陽創新科技(股)公司技術總監 凌陽科技(股)公司演算處處長 工研院電子所 IC 設計工程師	凌陽創新科技(股)公司技術總監	—	—	—	—

註 1：力晶創新投資控股(股)公司董事及總經理、晶幣科技(股)公司董事、Lonex Holding Limited 董事、愛普科技(股)公司董事（法人代表人）、力世創業投資(股)公司董事、智成電子(股)公司董事、智慧記憶科技(股)公司董事、力合量電子(股)公司董事、飛聖航空(股)公司董事、芯鼎科技(股)公司獨立董事、晶合集成電子(股)公司董事、瑞相科技(股)公司董事、新相量子光學(股)公司監察人（法人代表人）、力晶微元電子(股)公司董事、Poly-Magic materials corporation 董事、Powerchip Japan 董事（取締役）、Deutron Japan 董事。

註 2：本公司董事於 114 年 6 月 27 日股東常會全面改選。

註 3：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司董事長兼任總經理係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，本公司董事長密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司亦已增加一席獨立董事以提升董事會職能及強化監督功能。

2.法人股東之主要股東

114 年 10 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
力晶創新投資控股(股)公司	黃崇仁(4.75%)、陳嘉益(2.59%)、陳敏惠(1.13%)、黃崇恆(0.29%)、瑞聖(股)公司(1.25%)、智仁科技開發(股)公司(0.19%)、智成電子(股)公司(0.04%)、仁典投資(股)公司(0.73%)、力立企業(股)公司(0.2%)、世成科技(股)公司(0.78%)、利翔航太電子(股)公司(0.01%)、智翔投資(股)公司(1.34%)
銳邑科技(股)公司	黃俊祥(88.00%)、歐元黃(12.00%)
佶元投資(股)公司	溫士昆(82.50%)、溫士和(5.00%)、曾智億(5.00%)、周永秀(2.5%)、溫本雄(2.5%)、莊雨滿(2.5%)
展成技研有限公司	鄭正成(39%)、鄭添乾(25%)、鄭宇翔(18%)、鄭宇彤(18%)
Technoprobe S.p.A.	義大利商 T-PLUS S.p.A.(56.43%)、荷蘭商 Teradyne International Holodings B.V.(10%)、盧森堡商 Alba Europe SARL.(6.01%)

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人股東之主要股東
瑞聖(股)公司	力元投資股份有限公司(100%)
智翔投資股份有限公司	世成科技股份有限公司(39.3%) 力晶創新投資控股股份有限公司(26.37%) 力信投資股份有限公司(21.53%) 力宇創業投資股份有限公司(3.46%) 智立投資股份有限公司(1.16%) 智仁科技開發股份有限公司(1.02%) 力世創業投資股份有限公司(0.88%) 智豐科技股份有限公司(0.82%) 智成電子股份有限公司(0.42%) 悅山投資股份有限公司(0.26%)
世成科技股份有限公司	智翔投資股份有限公司(25.10%) 力晶創新投資控股股份有限公司(24.54%) 力信投資股份有限公司(20.40%) 力宇創業投資股份有限公司(8.15%) 力世創業投資股份有限公司(5.20%) 智仁科技開發股份有限公司(2.72%) 利翔航太電子股份有限公司(1.65%) 黃毓秀(1.07%) 悅山投資股份有限公司(0.99%) 黃崇仁(0.88%)
仁典投資股份有限公司	黃崇仁(99.92%)

法　　人　　名　　稱	法　人　股　東　之　主　要　股　東
	黃毓秀(0.08%)
智仁科技開發股份有限公司	力信投資股份有限公司(24.31%) 智翔投資股份有限公司(20.41%) 力晶創新投資控股股份有限公司(15.57%) 智立投資股份有限公司(7.04%) 力元投資股份有限公司(5.19%) 世成科技股份有限公司(4.77%) 世仁投資股份有限公司(4.23%) 智豐科技股份有限公司(3.69%) 仁典投資股份有限公司(3.19%) 林敦仁(1.65%)
智成電子股份有限公司	力信投資股份有限公司(17.77%) 世成科技股份有限公司(10.04%) 智翔投資股份有限公司(8.75%) 智仁科技開發股份有限公司(7.13%) 瑞聖股份有限公司(6.05%) 黃崇仁(3.84%) 元隆投資有限公司(3.83%) 智豐科技股份有限公司(3.59%) 力立企業股份有限公司(3.26%) 仁典投資股份有限公司(3.22%)
力立企業股份有限公司	黃崇仁(56.88%) 力元投資(股)公司(37.40%) 黃崇恆(3.11%) 黃毓秀(1.42%) 于素珊(0.75%) 余佩玲(0.37%) 黃美彌(0.07%)
利翔航太電子股份有限公司	行政院國家發展基金管理會(14.84%) 漢翔航空工業股份有限公司(13.09%) 力信投資股份有限公司(11.93%) 財政部國有財產署北區分署(6.66%) 世仁投資股份有限公司(5.72%) 中華開發資本股份有限公司(5.46%) 智立投資股份有限公司(5.05%) 創新工業技術移轉股份有限公司(4.37%) 高林實業股份有限公司(4.37%) 智翔投資股份有限公司(3.03%)
義大利商 T-PLUS S.p.A	Roberto Alessandro Crippa (37.06%) Cristiano Alessandro Crippa (37.06%) Monica Crippa(18.52%)

法人名稱	法人股東之主要股東
	Stefano Felici(7.36%)
荷蘭商 Teradyne International Holodings B.V.	美國商 Teradyne Inc(100%)
盧森堡商 Alba Europe SARL	西班牙商 CORPORACION FINANCIERA ALBA,S.A.(100.00%)

4.董事及監察人所具專業知識及獨立性情形

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
吳智孟	1. 本公司董事及獨立董事之相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 2. 本公司董事及獨立董事董監事皆未有公司法第 30 條各款情事。	本公司之董事間，未有超過半數之席次具有配偶或二親等以內之親屬關係，並無違反證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定之情事；另獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	-
力晶創新投資控股(股)公司 法人代表人：謝明霖			1
銳邑科技(股)公司 法人代表人：黃俊祥			-
佶元投資(股)公司 法人代表人：温士昆			-
展成技研有限公司 法人代表人：鄭添乾			-
Technoprobe S.p.A. 法人代表人：HELLEN KEE			-
沈維民			2
張懿云			2
顏志達			1
林焜尉			-

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會成員多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司董事會整體應具備之能力如下：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								具備之能力					
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷	會計及財務分析	經營管理	產業知識	國際市場觀	領導決策能力
				41~50	51~60	61~70	3 年以下	超過 3 年						
吳智孟	中華民國	男	V		V				V		V	V	V	V
謝明霖	中華民國	男			V				V		V	V	V	V
黃俊祥	中華民國	男			V				V		V	V	V	V
温士昆	中華民國	男			V				V		V	V	V	V

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								具備之能力					
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷	會計及財務分析	經營管理	產業知識	國際市場觀	領導決策能力
				41~50	51~60	61~70	3年以下	超過3年						
鄭添乾	中華民國	男			V				V		V	V	V	
HELLEN KEE	新加坡	女		V					V	V	V	V	V	V
沈維民	中華民國	男				V	V		V	V	V	V	V	
張懿云	中華民國	女				V	V		V		V	V	V	
顏志達	中華民國	男			V		V		V	V	V	V	V	
林焜尉	中華民國	男				V	V		V		V	V	V	V

綜觀本公司第8屆董事會現任成員10席，包含4席獨立董事，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力，具備產業經驗和專業知識。本公司6席一般董事及4席獨立董事各有1席為女性；另就董事成員年齡分布區間觀之，1席董事及獨立董事年齡介於41-50歲間，6席董事及獨立董事年齡介於51-60歲間，3席董事及獨立董事年齡介於61-70歲間。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養。

(2)董事會獨立性

本公司董事(含獨立董事)共計10席，彼此間並未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故本公司之董事間、監察人間或監察人與董事間，未有超過半數之席次具有配偶或二親等以內之親屬關係，並無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 30 日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	吳智孟	男	105.05.27	1,068,000	2.64	377,000	0.93	2,711,244	6.7	國立中央大學機械所碩士 中強光電(股)公司研發部處長 天瀚科技(股)公司研發部處長 揚明光學(股)公司研發部處長	註 1	新產品事業處特助	吳政忠	二親等	註 2
業務部副總	中華民國	林俊忠	男	106.11.02	16,000	0.04	—	—	—	—	國立中山大學公共事務管理研究所碩士 點晶科技(股)公司總經理室特助 點晶科技(股)公司軸心事業處處長 點晶科技(股)公司軸心事業處副處長 點晶科技(股)公司軸心事業處專案經理	—	—	—	—	—
技術服務部協理	中華民國	張家榮	男	115.03.10	3,000	0.01	—	—	—	—	中原大學機械研究所 九驊科股份有限公司研發部門協理 峻立科技股份有限公司研發部門經理	—	—	—	—	—
新產品事業處特助	中華民國	吳政忠	男	113.06.03	33,000	0.08	—	—	—	—	萬能工商專校電子工程系 富智康國際(股)公司項目管理部技術處長 連營科技(股)公司-系統開發部主任	—	總經理	吳智孟	二親等	—
高雄事業處副總	中華民國	張簡毅仁	男	106.07.03	2,000	0	—	—	—	—	國立澳洲大學資訊科技所 旭聯科技(股)公司-軟體開發部專案經理 智崴資訊科技股份有限公司多媒體事業處資深工程師	—	—	—	—	—
財務部副總	中華民國	伍建仲	男	113.11.15	8,035	0.02	—	—	—	—	中原大學會計系學士 資誠聯合會計師事務所審計部協理 瀚薪科技(股)公司財會處長	—	—	—	—	註 3
稽核室資深經理	中華民國	江紹詮	男	109.08.03	72,200	0.18	—	—	—	—	國立成功大學工業與資訊管理碩士 鴻海精密(股)公司 CPBG 生產企劃處資深專理 台灣資生堂(股)公司生產統括課課長 隆達電子(股)公司生產企劃課副理	—	—	—	—	—
財務部協理兼公司治理主管	中華民國	張琪琪	女	114.07.14	11,000	0.03	—	—	—	—	國立中正大學財務金融研究所碩士 六暉控股(股)公司總經理室協理兼任公司治理主管	註 4	—	—	—	—

註 1：本公司董事長、上海創崴醫療器械有限公司董事長及 Vision Wealth Global Co., Ltd.代表人。

註 2：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司董事長兼任總經理係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，本公司董事長密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司亦已增加一席獨立董事以提升董事會職能及強化監督功能。

註 3：伍建仲財務副總於 113 年 11 月 15 日到任，並於 113 年 12 月 31 日董事會追任。

註 4：利勤實業股份有限公司獨立董事。張琪琪財務協理兼任公司治理主管於 114 年 7 月 14 日到任，並經 114 年 8 月 6 日董事會任命。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事之酬金

單位：新臺幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	吳智孟	—	—	—	—	8,409 3.69%	8,409 3.69%	160	160	8,569 3.76%	8,569 3.76%	6,202 2.72%	6,202 2.72%	—	—	— (註 4)	—	— (註 4)	—	14,771 6.48%	14,771 6.48%	—
董事	力晶創新投資控股(股)公司法人代表人：謝明霖																					
董事	銳邑科技(股)公司法人代表人：黃俊祥																					
董事	佶元投資(股)公司法人代表人：溫士昆																					
董事	展成技研有限公司法人代表人：鄭添乾																					
董事	Technoprobe S.p.A.法人代表人：Hellen Kee(註 1)																					
董事	YQ Technology Company Limited 法人代表人：羅貫允(註 3)																					
獨立董事	沈維民(註 2)	1,013	1,013	—	—	2,745	2,745	100	100	3,858 1.69%	3,858 1.69%	—	—	—	—	—	—	—	—	3,858 1.69%	3,858 1.69%	—
獨立董事	張懿云(註 2)																					
獨立董事	顏志達(註 2)																					
獨立董事	林焜尉(註 2)																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：獨立董事之酬金係依據本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」第三條辦理，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：Technoprobe S.p.A.於 114 年 2 月 11 日股東臨時會選任。

註 2：沈維民、張懿云、顏志達及林焜尉四位獨立董事於 114 年 6 月 27 日股東常會選任。

註 3：法人董事薩摩亞商 YQ Technology Company Limited 於 114 年 6 月 27 日股東常會選任，後於 114 年 7 月 28 日辭任。

註 4：截至年報刊印日止，民國 115 年 3 月 10 日董事會通過員工酬勞總數為 31,986 千元，惟尚未決議個別對象發放金額。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	YQ Technology Company Limited 法人代表人：羅貫允、沈維民、張懿云、顏志達、林焜尉	YQ Technology Company Limited 法人代表人：羅貫允、沈維民、張懿云、顏志達、林焜尉	YQ Technology Company Limited 法人代表人：羅貫允、沈維民、張懿云、顏志達、林焜尉	YQ Technology Company Limited法人代表人：羅貫允、沈維民、張懿云、顏志達、林焜尉
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	力晶創新投資控股(股)公司法人代表人：謝明霖、銳邑科技(股)公司法人代表人：黃俊祥、佶元投資(股)公司法人代表人：溫士昆、展成技研有限公司法人代表人：鄭添乾、Technoprobe S.p.A.法人代表人：HELLEN KEE	力晶創新投資控股(股)公司法人代表人：謝明霖、銳邑科技(股)公司法人代表人：黃俊祥、佶元投資(股)公司法人代表人：溫士昆、展成技研有限公司法人代表人：鄭添乾、Technoprobe S.p.A.法人代表人：HELLEN KEE	力晶創新投資控股(股)公司法人代表人：謝明霖、銳邑科技(股)公司法人代表人：黃俊祥、佶元投資(股)公司法人代表人：溫士昆、展成技研有限公司法人代表人：鄭添乾、Technoprobe S.p.A.法人代表人：HELLEN KEE	力晶創新投資控股(股)公司法人代表人：謝明霖、銳邑科技(股)公司法人代表人：黃俊祥、佶元投資(股)公司法人代表人：溫士昆、展成技研有限公司法人代表人：鄭添乾、Technoprobe S.p.A.法人代表人：HELLEN KEE
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	吳智孟	吳智孟	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-	吳智孟	吳智孟
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11 人	11 人	11 人	11 人

註 1：截至年報刊印日止，民國 115 年 3 月 10 日董事會通過員工酬勞總數為 31,986 千元。

(二) 監察人之酬金

單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
監察人	陳素美(註 1)	—	—	42 0.02%	42 0.02%	—	—	42 0.02%	42 0.02%	—
監察人	丘于川(註 1)									

註 1：114 年 6 月 27 日股東常會選任獨立董事，成立審計委員會取代監察人。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳素美、丘于川	陳素美、丘于川
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2 人	2 人

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	吳智孟	13,947	13,947	—	—	2,795	2,795	2,933	—	2,933	—	19,675 8.64%	19,675 8.64%	—
副總經理	張簡毅仁													
副總經理	林俊忠													
副總經理	伍建仲													
特助	廖健評													
特助	吳政忠													

註：截至年報刊印日止，民國 115 年 3 月 10 日董事會通過員工酬勞總數為 31,986 千元，惟尚未決議個別對象發放金額。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	廖健評	廖健評
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	張簡毅仁、吳政忠、伍建仲	張簡毅仁、吳政忠、伍建仲
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	林俊忠	林俊忠
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	吳智孟	吳智孟
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	6 人	6 人

註 1：因本公司尚未決議員工酬勞個別對象發放金額，故酬金級距表未含 115 年 3 月 10 日董事會通過之員工酬勞總數 31,986 千元。

註 2：廖健評離職日：115/02/28。

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元；%

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	總經理	吳智孟	-	註 2	註 2	註 2
	副總經理	張簡毅仁				
	副總經理	林俊忠				
	副總經理	伍建仲				
	特助	廖健評				
	特助	吳政忠				
	公司治理主管	張琪琪(註 1)				
	業務部協理	黃琬婷(註 1)				
	售服部協理	張家榮(註 1)				

註1：公司治理主管張琪琪女士於114年7月14日到任，並經114年8月6日董事會任命。黃琬婷與張家榮自115年3月10日董事會通過成為經理人。

註2：本公司尚未決議員工酬勞個別對象發放金額，僅於115年3月10日董事會通過之全體員工酬勞總數31,986千元。

(五) 酬金政策

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣仟元； %

項目	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事酬金總額	5,191	5,191	12,167	12,167
董事酬金總額占稅後純益比例	3.46	3.46	5.34	5.34
監察人酬金總額	1,731	1,731	42	42
監察人酬金總額占稅後純益比例	1.15	1.15	0.02	0.02
總經理及副總經理酬金總額	21,601	21,601	19,675	19,675
總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	14.41	14.41	8.64	8.64

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

A.董事及監察人

本公司董事及監察人之酬勞依公司章程規定，當年度如有獲利由董事會決議以股票或現金分派發放，應提撥不高於 5%為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥董監酬勞。

B.總經理及副總經理

本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。

綜上所述，本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，除基本薪酬外，其他獎勵部份，則與經營績效呈正向關聯性，並依據法令規定揭露給付金額。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 第八屆董事會於114年6月27日起，截至年報刊印日止，本公司董事會開會7次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B / A】(註 1)	備註
董事長	吳智孟	7	-	100	
董事	力晶創新投資控股(股)公司 法人代表人：謝明霖	7	-	100	
董事	銳邑科技(股)公司 法人代表人：黃俊祥	7	-	100	
董事	佶元投資(股)公司 法人代表人：溫士昆	7	-	100	
董事	展成技研有限公司 法人代表人：鄭添乾	7	-	100	
董事	Technoprobe S.p.A. 法人代表人：HELLEN KEE	7	-	100	
董事	薩摩亞商 YQ Technology Company Limited (註 2) 法人代表人：羅貫允	2	-	100	
獨立董事	沈維民	7	-	100	
獨立董事	張懿云	7	-	100	
獨立董事	顏志達	7	-	100	
獨立董事	林焜尉	7	-	100	
註 1：本公司於 114 年 6 月 27 日股東常會全面改選。 註 2：薩摩亞商 YQ Technology Company Limited 已於 114 年 7 月 28 日辭任。					

2. 董事會其他應記載事項

(1)、證券交易法第14條之3所列事項：本公司已依法設置審計委員會，請參閱「審計委員會運作情形」之說明

(2)、除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

(3)、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應述明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會屆次及開會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	議案決議情形
第7屆第8次 113/1/18	董事長 吳智孟	民國112年員工認股權憑證發行名單，提請討論。	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
第7屆第11次 113/7/8	董事長 吳智孟	核定員工認股權憑證發行名單及其權利期間案。	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	書面表決結果：4票贊成，0票反對，本議案通過。
第7屆第12次 113/9/26	董事長 吳智孟	民國113年員工認股權憑證發行名單，提請討論。	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。

第 7 屆第 16 次 114/3/11	董事長 吳智孟	113 年度董事、監察人及員工酬勞案，提請決議。	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經主席徵詢其餘出席董事同意：1.照原議案通過。2.員工酬勞提撥比例，未來每年提撥比例將提請薪資報酬委員會討論後再提交董事會進行決議。
第 7 屆第 18 次 114/5/29	董事 Technoprobe S.p.A. 法人代表人： HELLEN KEE	為擬與關係人進行交易案	涉及自身利益，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
第 8 屆第 2 次 114/7/10	董事 Technoprobe S.p.A. 法人代表人： HELLEN KEE	與關係人 Technoprobe S.p.A.交易案	涉及自身利益，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
第 8 屆第 3 次 114/8/6	董事長 吳智孟	114 年第一次員工認股權憑證發行計畫擬給予之員工名單	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經沈維民獨立董事代理主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
第 8 屆第 6 次 115/1/20	董事長 吳智孟	2025 年度經理人年終獎金發放案	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經吳智孟董事長利益迴避，張懿云獨立董事代理主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
第 8 屆第 6 次 115/1/20	董事 Technoprobe S.p.A. 法人代表人： HELLEN KEE	與關係人 Technoprobe S.p.A.交易案	涉及自身利益，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
第 8 屆第 7 次 115/3/10	董事長 吳智孟	本公司初次上櫃前現金增資案經理人獲配名單案	董事長吳智孟兼任本公司總經理，利害迴避未討論此案及表決。	表決結果：經吳智孟董事長利益迴避，張懿云獨立董事代理主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。

(4)、 董事會評鑑執行情形：本公司已於 114 年 5 月 29 日董事會決議通過訂定「董事及經理人績效評估管理辦法」，並於 115 年 1 月執行董事會績效評估，且已於 115/1/20 董事會報告，評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊請詳下表。

評估週期	每年執行一次
評估期間	114 年度
評估範圍	1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會之績效評估
評估方式	包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
評估內容	1.董事會內部自評 (1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事之選任及持續進修 (5)內部控制 2.董事成員自評 (1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制 3.功能性委員會之績效評估 (1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制

(5)、 加強董事會職能之目標

A. 本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。

B. 本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規範」以資遵循。

C. 為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，使其全心全意發揮職能，為股東創造最大利益。

D. 本公司秉持營運透明、注重股東權益，於公司網站設有「投資人專區」及「永續發展」，及時提供相關資訊。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

本公司於 114 年 6 月 27 日設置審計委員會，最近年度截至年報刊印日止，審計委員會開會 6 次【A】，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	沈維民	6	-	100	
獨立董事	張懿云	6	-	100	
獨立董事	顏志達	6	-	100	
獨立董事	林焜尉	6	-	100	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

會議日期	議案內容及後續處理	證交法14-5所列事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
第一屆第一次 114/7/10	第一案：本公司衍生性金融商品額度申請案	✓	無
	第二案：與關係人 Technoprobe S.p.A. 交易案	✓	無
	審計委員會決議：全體出席委員同意照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第一屆第二次 114/8/6	第一案：本公司擬購置不動產交易案暨授權對標的廠房進行修繕額度案	✓	無
	第二案：本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案	✓	無
	第三案：本公司 114 年第二季合併財務報表案	✓	無
	第四案：評估本公司自行編製財務報告能力案	✓	無
	第五案：本公司擬訂定「114 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案	✓	無
	第六案：114 年第一次員工認股權憑證發行計畫擬給予之員工名單	✓	無
	審計委員會決議：全體出席委員同意照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第一屆第三次 114/10/9	第一案：設備售後委外服務合約(銳邑科技)擬由沈維民董事代表簽約	✓	無
	審計委員會決議：全體出席委員同意照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第一屆第四次 114/11/12	第一案：本公司大甲區新廠建設預算案	✓	無
	第二案：本公司 114 年第三季合併財務報表案	✓	無
	第三案：修訂內部控制制度	✓	無
	第四案：內部控制制度聲明書案	✓	無
	第五案：114 年第一次員工認股權憑證第二次發行擬給予之員工名單	✓	無

	審計委員會決議：全體出席委員同意照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第一屆第五次 115/1/20	第一案：本公司 2026 年度營運計劃暨預算案	✓	無
	第二案：2026 年度本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司稽核計劃案	✓	無
	第三案：與關係人 Technoprobe S.p.A.交易案	✓	無
	審計委員會決議：全體出席委員同意照案通過。		
第一屆第六次 115/3/10	第一案：本公司 114 年度內部控制制度聲明書案	✓	無
	第二案：本公司 114 年度營業報告書暨財務報表案	✓	無
	第三案：本公司 114 年度盈餘分派案	✓	無
	第四案：本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案	✓	無
	第五案：本公司簽證會計師更換案及 115 年度財務報表核閱/查核簽證報酬案	✓	無
	第六案：設備售後委外服務合約(昆山群岱)擬由沈維民董事代表簽約	✓	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）

(1) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

本公司內部稽核主管每季一次向獨立董事說明內部稽核執行情形，定期列席董事會報告稽核業務，並按月以電子郵件方式向獨立董事呈送稽核報告。

(2) 獨立董事與會計師溝通情形：

本公司簽證會計師每季一次向獨立董事說明財務報表查核或核閱結果，及其他相關法令要求之溝通事項，會計師與本公司獨立董事溝通狀況良好。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已參照上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」並依循相關法規於本公司網站及公開資訊觀測站揭露，以維護投資大眾、利害關係人及員工之權益。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
二、公司股權結構及股東權益				
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司依「公司治理實務守則」設置發言人及代理發言人制度，處理股東建議、疑義及糾紛事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司設有專人負責每月申報內部人及其關係人股權異動，且委由專業股務代理公司協助處理股務事項，能掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司已依法令規定設置內部相關作業程序，訂有「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「子公司監督管理辦法」等相關規範，建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
三、董事會之組成及職責				
（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第三章強化董事化職能及「董事選舉管理辦法」，明確規範董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 目前董事會成員由10名董事(含4位獨立董事)組成，成員背景涵蓋營運判斷、會計及財務分析、經營管理、產業知識、國際市場觀、領導決策能力及法律專業等多元專長，能有效支撐公司經營及未來發展策略。另本公司為落實董事會多元化之具體管理目標，本公司現有董事中包含2位女性董事，展現公司對性別平衡與多元化的持續重視。	
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 本公司已遵循主管機關之規定設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於114年11月12日董事會通過設置「永續管理委員會」。	符合上市上櫃治理治理實務守則規定。
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司已於114年5月29日董事會決議通過訂定「董事及經理人績效評估管理辦法」，於115年元月份執行董事會績效評估，並且已於115/1/20董事會報告。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司審計委員會每年參考審計品質指標(AQIs)評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，並檢核會計師未擔任本公司董事、經理人或重大影響之職務，亦非利害關係人，且無直接及間接利益衝突情事。 最近一年度評估結果業經114年8月6日審計委員會同意，並提報同日之董事會決議通過對會	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

<table>
<tr><td rowspan="2">評估項目</td><td colspan="3">運作情形</td><td rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</td></tr>
<tr><td>是</td><td>否</td><td>摘要說明</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>計師之獨立性及適任性評估。</td><td></td></tr>
<tr><td>四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？</td><td>V</td><td></td><td>本公司已於114年8月6日經董事會通過委任財務部協理張琪琪兼任公司治理主管，負責公司治理相關業務，包括但不限於辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
公司治理主管進修情形：
<table>
<tr><td>日期</td><td>課程名稱</td><td>主辦單位</td><td>時數</td></tr>
<tr><td>114/07/09</td><td>2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>臺灣證券交易所</td><td>6</td></tr>
<tr><td>114/08/25</td><td>114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會</td><td>證券櫃檯買賣中心</td><td>3</td></tr>
<tr><td>114/09/19</td><td>公司治理與證券法規</td><td>台灣科學園區科學工業同業公會</td><td>3</td></tr>
<tr><td>115/01/20</td><td>公司治理與證券法規</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>符合上市上櫃公司治理實務守則規定。</td></tr>
<tr><td>五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利</td><td>V</td><td></td><td>本公司於公司網站設有「利害關係人」專區，並建立多元溝通管道：對內設有員工意見箱並定期召開勞資會議；對外則提供投資人信箱、不定期舉辦溝</td><td>符合上市上櫃公司治理實務守則規定。</td></tr>
</table>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
害關係人所關切之重要企業社會責任議題？			通會議、供應商評鑑及客戶不定期稽核與訪談等方式，以確保利害關係人之意見能即時傳達並獲得妥適回應。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會相關事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
七、資訊公開				
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司已架設公司網站 (https://www.inno-stars.com/)，並揭露財務業務及公司治理資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二)本公司已架設英文網站，提供國外投資人了解公司相關財務及業務資訊，對外資訊皆有相關部門負責依規定蒐集及揭露，且依規定落實發言人制度。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司係興櫃公司，已依主管機關對興櫃公司之規定，於期限內公告年度財務報告與各月份營運情形。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益：本公司依法遵守政府各項法律規章，注意勞工權益，舉凡員工之聘僱、離職、退休各項福利措施等，均依勞動基準法及相關法令規定辦理。 (二)僱員關懷：本公司成立福委會，並定期舉辦勞資會議，增加勞資雙方良好之互動，溝通管道順暢，勞資關係和諧穩定。 (三)投資者關係：本公司依相關法令規定召集股東會，亦給予股東充分發問及提案之機會，另設	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛事項。 (四)供應商關係：本公司與供應商均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。 (五)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，直接與利害關係人溝通，尊重及維護其應有合法權益。 (六)董事進修：本公司董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，公司亦不定期安排董事參加專業知識進修課程。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：除依法訂定各種內部規章及制度，進行各種風險管理及評估、由內部稽核定期查核執行情形外，另投保相關保險如財產保險等以規避風險。 (八)客戶政策之執行情形：本公司秉持誠信經營守則，與客戶均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。 (九)本公司為董事購買責任保險之情形：已為董事購買責任保險，保險期間為115年3月17日至116年3月17日，投保金額美金壹千萬元。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司未列入受評公司，故不適用。				

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
本屆召集人暨獨立董事	張懿云	**學歷：** 德國慕尼黑大學法學博士 **經歷：** 輔仁大學財經法律系教授 經濟部智慧局法律諮詢顧問 交通部訴願審議委員會委員 教育部公費留學審議會委員	本公司四位薪酬委員並無違反「股票於上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」中有關獨立性規範之情事。	2
獨立董事	沈維民	**學歷：** 美國 Purdue University 會計學博士 **經歷：** 國立臺中科技大學財政稅務系教授 東海大學會計系副教授		2
獨立董事	顏志達	**學歷：** 國立政治大學財政學系博士 **經歷：** 國立台中科技大學財政稅務系副教授		1
獨立董事	林焜尉	**學歷：** 國立交通大學光電工程博士 **經歷：** 凌陽創新科技股份有限公司技術總監 凌陽科技股份有限公司演算處處長 工研院電子所 IC 設計工程師		-

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期： 114 年 6 月 27 日至 117 年 6 月 26 日，最近年度及當年度截至年報刊印止，委員資格及出席情形如下：

A.第二屆薪資報酬委員會自114年6月27日起至年報刊印止，本公司薪資報酬委員會開會4次【A】，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	張懿云	4	-	100	
委員	沈維民	4	-	100	
委員	顏志達	4	-	100	
委員	林焜尉	4	-	100	

B.第一屆薪資報酬委員會任期 114 年 3 月 11 日至 114 年 6 月 26 日，本公司薪資報酬委員會開會 1 次【A】，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	張懿云	1	-	100	
委員	沈維民	1	-	100	
委員	顏志達	1	-	100	
委員	林焜尉	1	-	100	

其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司已訂定「永續發展實務守則」，並於 114 年 11 月 12 日董事會通過設置永續管理委員會並通過「永續發展委員會組織規程」，由董事長吳智孟擔任主席，與多位高階主管帶領的工作小組共同負責公司永續發展政策、制度及推動計畫，並每年向董事會報告執行情形。	無重大差異之情事。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司已訂定「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」、「永續發展實務守則」等，藉由各項管理程序的持續運行，對於營運相關之環境、員工安全、客戶、供應商及各利害關係人等風險予以掌握及因應，以確保本公司所面臨之風險已被知悉，且在可承受程度內達成永續經營之目的。	無重大差異之情事。
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司已訂定「環境保護政策」，並遵循相關環境法規、國際協議及在地法令，如：《空氣污染防制法》《溫室氣體減量及管理法》等。	無重大差異之情事。
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司致力於節能減碳改善，同仁皆依規定遵循隨手關燈及冷氣，以有效節約能源、推動無紙化線上簽核作業，以有效降低紙張、鼓勵同仁使用非拋棄式之飲食器皿並落實垃圾分類及資源。	無重大差異之情事。
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司最近年度之水電費用佔營收及成本百分比為 0.61% 及 2.83%，影響程度尚屬有限。本公司隨時注意國內外企業社會責任相關準則及企業環境之變遷，據以檢討現行永續發展相關制度，以履行企業社會責任。	無重大差異之情事。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	本公司非屬高耗能產業，目前尚未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，預計於 2026 年開始進行盤查。 雖本公司針對上述項目尚未進行管理，但始終持續響應節能減碳政策，提倡隨手關燈、減少用水、冷氣溫度控制、落實資源回收等，廢棄物則皆委託專業廠商處理回收。另外，預計 2026 年動工之新建廠區已於地下樓層規劃雨水回收池，除可因應極端氣候可能帶來之缺水危機，亦能在豪大雨時，發揮滯洪池調節之功能。	本公司將持續評估，並依法令規定計畫辦理。
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司依循《世界人權宣言》、《聯合國企業與人權指導原則》、《國際勞工組織核心勞動標準》及《聯合國全球盟約》等基本人權原則，制定內控制度管理辦法，恪遵下列原則以維護人權：(1) 多元包容及無歧視；(2) 同工同酬；(3) 反對強迫勞動；(4) 反對僱用童工；(5) 人道待遇。	無重大差異情形。
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司已訂定「工作規則」，其內容包含薪酬、休假及其他員工福利措施，本公司亦將經營成果適當反應於員工薪酬。	無重大差異情形。
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司已設置「職業安全衛生委員會」，負責審議協議員工年度健康檢查、特約護理人員臨場服務、健康管理與促進措施，同時定期辦理安全衛生教育訓練課程，藉此提升員工自我保護意識，並建立支持性職場文化，並定期每季召開會議，針對各項安全衛生議題進行檢討與改善。 本公司亦依《勞工作業環境監測實施辦法》之規定，每半	無重大差異情形。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>年委託勞動部認可之作業環境監測機構，針對化學性、物理性等危害因子進行定期監測，確保員工暴露濃度值低於法定標準。此外，職業安全衛生專責人員亦定期巡查工作現場，執行作業前之危害鑑別與風險評估，並據以提出預防與控制對策，以強化職場安全保障。
為進一步落實職場安全衛生管理，本公司已訂定《職業安全衛生工作守則》，並於 2025 年 7 月 17 日公告實施，明確規範各級主管與全體員工之職責與義務，確保工作環境安全與員工健康照護，防範傷害、疾病與職業災害之發生。
本公司民國 114 年度，截至年報刊印日止，安全衛生管理狀況良好，未曾發生員工職業災害事件及任何火災事故。</td><td></td></tr>
<tr><td>（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</td><td>V</td><td></td><td>本公司訂定「教育訓練管理程序書」，每年訂定教育訓練計劃執行，執行內容包含：新人訓練（公司基本介紹、人事管理規章、品質政策及目標解說等）、內部訓練（資訊安全宣導、品質管制等）、外部訓練（特定人員專業進修、堆高機訓練、機械安全、風險管理等），由員工自願參加訓練，或各部門主管安排人員工作內容需求參加訓練。
114 年 1-12 月教育訓練實施情形統計及支出如下：
<table>
<tr><th>114 年 1-12 月
教育訓練</th><th>新進人員
訓練</th><th>內部訓練</th><th>外部訓練</th></tr>
<tr><td>訓練時數（小時）</td><td>175</td><td>303</td><td>188</td></tr>
<tr><td>訓練人次（人）</td><td>70</td><td>281</td><td>25</td></tr>
<tr><td>訓練費用（元）</td><td>-</td><td>15,000</td><td>58,000</td></tr>
</table></td><td>無重大差異情形。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>113 年教育訓練實施情形統計及支出如下：<table><tr><th>113 年
教育訓練</th><th>新進人員
訓練</th><th>內部訓練</th><th>外部訓練</th></tr><tr><td>訓練時數（小時）</td><td>87</td><td>-</td><td>89</td></tr><tr><td>訓練人次（人）</td><td>29</td><td>-</td><td>6</td></tr><tr><td>訓練費用（元）</td><td>-</td><td>-</td><td>14,000</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</td><td>V</td><td></td><td>本公司針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，均依照相關法規及國際準則執行。本公司已訂定「客戶滿意度管理程序書」、「客戶抱怨處理程序書」等，保護客戶權益，並由業務部門負責客戶諮詢及申訴管道。</td><td>無重大差異情形。</td></tr>
<tr><td>（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</td><td>V</td><td></td><td>半導體精密自動化設備主要關鍵原材料為精密伺服驅動馬達系統、人機協作自動控制系統以及精密工業視覺元件模組系統等材料，本公司訂定 「採購管理程序書」及「供應商管理程序書」，透過嚴格審核與評選制度，優先以品質、可靠度、穩定度及環境安全為考量，同時透過定期稽核制度審查合格供應商績效。</td><td>無重大差異情形。</td></tr>
<tr><td>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</td><td></td><td>V</td><td>本公司目前不屬於法令規定應編製永續報告書之範圍，故尚未編製永續報告書，未來將視法令規定及公司營運需要編製。但本公司已於公司網站、年報及公開資訊觀測站等處揭露公司非財務資訊情形，並不定期於公司網站更新相關資訊供大眾參閱。</td><td>未來將視公司發展及配合法令規定辦理。</td></tr>
<tr><td colspan="5">六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：公司已訂定「永續發展實務守則」，無重大差異。</td></tr>
<tr><td colspan="5">七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。</td></tr>
</table>

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司董事會通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，並揭示公開交易資訊觀測站及公司網站，明確要求公司董事、經理人、受僱人、受任人或具實質控制能力者，在商業行為過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，亦不得從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以避免以不當方式取得或維持利益。 公司秉持廉潔、透明與負責的經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立健全的公司治理與風險控管機制，以營造永續發展的經營環境。	無重大差異情形。
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明訂禁止提供或接受不正當利益、提供或承諾任何疏通費、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、從事不公平競爭、防範產品或服務損害利害關係人、禁止內線交易等各種不誠信行為及防範措施。	無重大差異情形。
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三)本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，明確規定不合法行為，以及發現違規時受理之檢舉管道及處理流程，懲戒之規定則依照「工作規則」處置，另上述之管理辦法亦定期檢視，如有增修之必要時，將會進行修改並依辦法核決程序辦理。	無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)本公司於往來客戶及供應商皆經適當評鑑機制，並依據往來交易記錄予以評估本公司之商業夥伴之誠信狀況，作次年度的授信考評評估事項。	無重大差異情形。
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)本公司指定稽核室為推動企業誠信經營專責單位，隸屬於董事會，定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督其執行情形。	無重大差異情形。
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司已依法令制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等相關辦法，明訂利益衝突之相關政策，並鼓勵內部及外部人員呈報任何不誠信或不當行為。	無重大差異情形。
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)本公司已依據「誠信經營守則」建立有效的會計制度、內部控制制度，遵循誠信原則與執行，並隨時檢討，俾確保其持續有效進行。稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。另本公司截至年報刊印日止未有發生不誠信行為之情事。	無重大差異情形。
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)公司不定期舉辦誠信經營等相關課程，並於公司網站公告相關辦法，以落實執行誠信經營政策。	無重大差異情形。
三、公司檢舉制度之運作情形				
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，	V		(一)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，於公司網站公告申訴受理電話與檢舉信箱，	無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？			對於違規誠信相關情事，員工可具名或匿名透過電話與信箱反應申訴。本公司由稽核處為檢舉案件之受理單位。檢舉管道資訊如下： 1.檢舉專線：04-2680-1202 #1310 2.檢舉信箱：integrity@inno-stars.com 3.受理單位：稽核室	
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂有檢舉案件處理流程、檢舉人保護機制等規定，規範檢舉案件受理、調查過程與結果及後續措施，並對於檢舉人身分予以保密，保障檢舉人及被檢舉人之合法權益。	無重大差異情形。
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，適用範圍涵蓋本公司全體董事、經理人、員工、承攬商、供應商、顧問及其他利害關係人。本公司致力於建立完善的檢舉人保護機制，嚴禁任何報復行為，包括降職、解雇、刁難、威脅等。如有報復行為，經查屬實者，公司將依法懲處。本公司民國114年度截至年報刊印日止，尚未接獲任何檢舉案件。	無重大差異情形。
四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則等相關公司辦法。	無重大差異情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，以建立誠信經營之企業文化，實際運作與守則並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
1.本公司遵守公司法、證交法、商業會計法及上市上櫃相關規章，以作為誠信經營之基本要求。 2.本公司「董事會議事運作管理辦法」明定董事迴避之相關規定，董事會所列之議案，如涉自身利益，於表決程序應自行迴避，並不得代理其他董事協助表決。 3.本公司亦訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」、安排董事參與進修課程、不定期轉達主管機關宣導之法令。				

(七) 其他足以增進公司治理運作情形瞭解之重要資訊：相關資訊規章可於公開資訊觀測站查閱。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

創新服務股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年03月10日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、 七、本聲明書業經本公司民國115年03月10日董事會通過，出席董事10人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

創新服務股份有限公司

董事長暨總經理：吳智孟

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告

pwc 資誠

內部控制制度審查確信報告

資會綜字第 24008936 號

創新服務股份有限公司　公鑒：

後附創新服務股份有限公司（以下稱「貴公司」）謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 113 年 12 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行合理確信審查程序竣事。

標的、標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊係 貴公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度於民國 113 年 12 月 31 日之設計及執行情形，及 貴公司於民國 114 年 3 月 11 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書(以下併稱確信標的)。

用以衡量或評估上開確信標的之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故 貴公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

pwc 資誠

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則，維持完備之品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關確信標的之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之結論提供合理之依據。

確信結論

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目判斷， 貴公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度於民國113年12月31日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性； 貴公司於民國114年3月11日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

pwc 資誠

強調事項段

貴公司業已依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，針對取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、關係人交易之管理、財務報表編製流程之管理及對子公司之監督與管理訂定相關作業程序。本會計師未因此而修正確信結論。

資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧

會計師

李典易

中華民國 114 年 3 月 11 日

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議事項

開會日期	會議	重要決議事項
113.01.18	113年第一次股東臨時會	討論及選舉事項 1.修訂公司章程案。 2.補選董事案。 其他議案 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
113.06.19	113年股東常會	報告事項 1.民國111年度營業報告案。 2.民國111年度監察人審查報告案。 承認事項 1.本公司民國112年度財務報表暨營業報告書案。 2.民國111年度虧損撥補案。
113.10.17	113年第二次股東臨時會	報告事項 1. 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 2. 訂定本公司「道德行為準則」。 3. 訂定本公司「永續發展實務守則」。 4. 訂定本公司「公司治理實務守則」。 討論事項 1. 修訂公司章程案。
114.02.11	114年第一次股東臨時會	討論及選舉事項 1. 修訂公司章程案。 2. 增選董事案。 其他議案 1. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
114.06.27	114年股東常會	報告事項 1.民國一一三年度營業報告案。 2.民國一一二年度監察人審查報告案。 3.113年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案 4.股東常會受理股東提案情形報告案 承認事項 1.民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一一三年度盈餘分配案。 討論及選舉事項 1.公司章程修正案。 2.廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及增訂「董事選舉管理辦法」案 3.修正本公司背書保證管理辦法案 4.修正本公司資金貸與他人管理辦法案 5.本公司擬申請股票上市(櫃)案 6.初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案 7.本公司全面改選董事案

2. 董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
113.01.18	一、民國113年度營運計畫案。 二、民國113年度本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司稽核計畫案。 三、民國112年員工認股權憑證發行名單案。 四、擬訂定本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
113.03.27	一、112年度財務報表暨營業報告書案。 二、擬具112年度虧損撥補案。 三、擬修訂本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司「董事會議事運作管理辦法」案。 四、擬訂定本公司「內部人申報管理作業」案。 五、擬修訂本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司「內部控制制度」案。 六、召開本公司113年股東常會案。
113.06.19	一、本公司員工認股權憑證發行新股案。
113.07.08	一、核定員工認股權憑證發行名單及其權利期間案。
113.09.26	一、民國113年第二季財務報表案。 二、擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 三、擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 四、擬訂定本公司「道德行為準則」。 五、擬訂定本公司「公司治理實務守則」。 六、擬訂定本公司「永續發展實務守則」。 七、擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」。 八、擬修訂公司章程案。 九、本公司擬辦理股票全面無實體發行及訂定換發基準日案。 十、本公司員工認股權憑證發行新股案。 十一、發行員工認股憑證案。 十二、民國113年員工認股權憑證發行名單。 十三、召開113年第二次股東臨時會案。
113.10.30	一、TP策略合作案。 二、現金增資發行新股案。
113.12.31	一、通過申請登錄興櫃併送一般公開發行案。 二、擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 三、擬訂定「永續資訊之管理」案。 四、114年度本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司稽核計畫案。 五、變更本公司上市(櫃)輔導券商案。 六、追認本公司更換股務代理機構案。 七、追認本公司財務暨會計主管任命案。 八、本公司背書保證專用章變更保管人。
114.01.21	一、通過民國114年度營運計畫。 二、變更本公司營業登記地址案。 三、修訂公司章程案。 四、增設董事一席案。 五、解除董事競業限制案。

	六、召集114年第一次臨時股東會案。
114.03.11	一、113年度董事、監察人及員工酬勞案。 二、113年度財務報表暨營業報告書案。 三、113年度盈餘分派案。 四、設立薪資報酬委員會及委任委員案。 五、內部控制制度專案審查之內部控制制度聲明書案。 六、113年度內部控制制度聲明書案。 七、指派公司發言人及代理發言人案。 八、追認經理人案。 其他議案及臨時動議： 一、本公司因應未來公司營運需求，擬增設一席董事案。 二、本公司興櫃徵提股票KGI承銷案。
114.04.10	一、本公司全面改選董事案。 二、提名一般董事及獨立董事候選人暨資格審查案。 三、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 四、受理一般董事及獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他事項。 五、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 六、擬設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會行使職權辦法」案。 七、公司章程修正案。 八、廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及增訂「董事選舉管理辦法」案。 九、修正本公司董事會議事規則案。 十、修正本公司背書保證作業辦法案。 十一、修正本公司資金貸與他人辦法案。 十二、本公司擬向臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上市(櫃)案。 十三、初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 十四、訂定召開本公司114年股東常會相關事宜案。 十五、本公司受理114年股東常會股東提案之相關事宜案。 十六、授權其他董事會成員為稽核報告審閱暨簽核人員案。
114.05.29	一、訂定「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。 二、訂定本公司「董事及經理人績效評估管理辦法」案。 三、為擬與關係人進行交易案。
114.06.27	一、本公司董事長選舉案。
114.07.10	一、本公司委任第二屆薪資報酬委員會成員案。 二、訂定本公司除息相關事宜。 三、本公司衍生性金融商品額度申請案。 四、與關係人Technoprobe S.p.A.交易案 五、本公司上市／上櫃案
114.08.06	一、本公司擬購置不動產交易案暨授權對標的廠房進行修繕額度案。 二、本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 三、本公司114年第二季合併財務報表案。 四、評估本公司自行編製財務報告能力案。 五、通過基層員工定義案。 六、本公司委任財務部協理並兼任公司治理主管及經理人薪酬案。

	七、訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 八、本公司擬訂定「114年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 九、114年第一次員工認股權憑證發行計畫擬給予之員工名單。 十、擬與新光銀行申請融資案。
114.10.09	一、訂定113年員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 二、授權其他董事會成員為稽核報告審閱暨簽核人員案。 三、本公司發言人及代理發言人異動案。 四、本公司擬設置資訊安全專責主管案
114.11.12	一、本公司大甲區新廠建設預算案。 二、本公司114年第三季合併財務報表案。 三、修訂內部控制制度。 四、內部控制制度聲明書案。 五、本公司擬於初次上櫃前與主辦承銷商簽訂過額配售協議書，並協調特定股東自願集保案。 六、擬出具本公司114年第四季及115年第一季財務預測案。 七、114年第一次員工認股權憑證第二次發行擬給予之員工名單。 八、本公司擬設置永續發展委員會。
115.01.20	一、本公司2026年度營運計劃暨預算案。 二、2026年度本公司及子公司上海創崴醫療器械有限公司稽核計劃案。 三、本公司2025年度經理人年終獎金發放案。 四、與關係人Technoprobe S.p.A.交易案。
115.03.10	一、本公司114年度內部控制制度聲明書案。 二、本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 三、本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 四、本公司114年度盈餘分派案。 五、本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。 六、本公司初次上櫃前現金增資案經理人獲配名單案。 七、本公司專案獎勵機制-經理人獎金發放案。 八、本公司業務部處長黃琬婷晉升業務部協理及經理人薪酬案。 九、本公司召開115年度股東常會相關事宜案。 十、本公司簽證會計師更換案及115年度財務報表核閱/查核簽證報酬案。 十一、通過基層員工定義案。 十二、本公司委任張家榮為客戶技術服務部協理及經理人薪酬案。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事及監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。

四、 簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易 鄭雅慧	114年1月1日至114年12月31日	1,880	1,650	3,530	

註：非審計服務為內部控制專案審查660仟元、辦理工商登記及諮詢費570仟元、稅務簽證案件360仟元、差旅費60仟元。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少

者，應揭露更換前後審計公司金額及原因：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、 更換會計師資訊：有

因主管機關法令及該所執行會計師內部輪調之機制，本公司民國115年第一季起財務報表之查核簽證會計師由李典易會計師及鄭雅慧會計師變更為蔡欣怡會計師及白淑蒨會計師。

1. 關於前任會計師

更換日期	民國115年第一季		
更換原因及說明	因應主管機關法令及資誠聯合會計師事務所執行會計師內部輪調之機制。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用，係事務所內部輪調	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無此情形		

2. 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	蔡欣怡會計師；白淑蒨會計師
委任之日期	民國 115 年第一季起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無此情形
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

3. 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函。

六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓　名	114 年度		115 年 4 月 30 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長兼總經理	吳智孟	74,000	—	39,750	—
董事	銳邑科技(股)公司	(465,000)	—	—	—
	法人代表人：黃俊祥		—	—	—
董事	力晶創新投資控股(股)公司(註 1)	(325,000)	—	—	—
	法人代表人：謝明霖		—	—	—
董事	佶元投資(股)公司	(334,000)	—	—	—
	法人代表人：溫士昆		—	—	—
董事	展成技研有限公司	(570,806)	—	—	—
	法人代表人：鄭添乾	250,780	—	1,000	—
董事	陳舜耕(註 2)	—	—		
董事	Technoprobe S.p.A.(註 3)	3,400,000	—	—	—
	法人代表人：HELLEN KEE	—	—	—	—
董事	薩摩亞商 YQ Technology Company Limited(註 4)	3,400,000	—	—	—
	法人代表人：羅貫允	—	—	—	—
獨立董事	沈維民(註 5)	—	—	—	—
獨立董事	張懿云(註 5)	—	—	—	—
獨立董事	顏志達(註 5)	—	—	—	—
獨立董事	林焜尉(註 5)	2,000	—	—	—
監察人	陳素美(註 5)	(154,975)	—	—	—
監察人	丘于川(註 5)		—	—	—
業務部副總	林俊忠	(91,178)	—	(44,100)	—
財務部副總	徐靜美(註 6)	26,946	—	—	—
財務部副總	伍建仲(註 7)	25	—	8,010	—
高雄事業處副總	張簡毅仁	(25,000)	—	2,000	—
特助	廖健評(註 8)	(87,000)	—	—	—
特助	吳政忠	12,000	—	8,000	—
財務部協理兼公司治理主管	張琪琪(註 9)	—	—	11,000	—
業務部協理	黃琬婷(註 10)			10,000	
售服部協理	張家榮(註 10)			3,000	

註1：法人董事力晶創新投資控股(股)公司於113年1月18日股東臨時會選任。

註2：陳舜耕董事已於113年1月17日辭任。

註3：法人董事 Technoprobe S.p.A.於114年2月11日股東臨時會選任。

註4：法人董事薩摩亞商YQ Technology Company Limited於114年6月27日股東常會選任，並於114年7月28日辭任。

註5：沈維民、張懿云、顏志達及林焜尉獨立董事於114/6/27股東常會選任，成立審計委員會取代監察人。

註6：徐靜美財務副總於113年11月15日辭職。

註7：伍建仲財務副總於113年11月15日就任。

註8：廖健評特助於115年2月28日離職。

註9：張琪琪財務協理兼任公司治理主管於114年7月14日到任，並於114年8月6日董事會任命。
註10：黃琬婷業務協理、張家榮售服部協理自115年3月10日就任內部人。

2. 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉股權移轉之相對人為關係人者

單位：股； 新臺幣元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
吳智孟	贈與	113/08/22	吳○義	本人之配偶及二等親以內之親屬	85,000	14.309
吳智孟	贈與	113/08/22	吳○恩	本人之配偶及二等親以內之親屬	85,000	14.309
林俊忠	贈與	113/11/14	林○	本人之配偶及二等親以內之親屬	70,000	20.89
廖健評	贈與	113/03/18	廖○霖	本人之配偶及二等親以內之親屬	85,000	26.85
佶元投資股份有限公司	處分	114/02/04	Technoprobe S.p.A.	董事	283,000	65
展成技研有限公司	處分	114/02/24	鄭添乾	董事	63,813	23.5

3. 董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者

無股權質押情形。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年4月30日；單位；股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
薩摩亞商 YQ Technology Company Limited 代表人：劉婉玉	3,400,000	8.4	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
義大利商 Technoprobe S.p.A. 代表人：Cristiano Alessandro Crippa	3,400,000	8.4	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銳邑科技(股)公司 代表人：黃俊祥	3,382,813	8.35	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
慢利實業有限公司 代表人：吳慧娟	2,711,244	6.7	—	—	—	—	—	—	—
	377,000	0.93	1,068,000	2.64	—	—	吳智孟	配偶	—
力晶創新投資控股（股）公司	2,675,000	6.61	—	—	—	—	—	—	—

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
代表人：謝明霖	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SBI & PSMC JV Fund LP 代表人：SBI & PSMC MANAGEMENT CO., LTD.	1,665,000	4.11	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富啟投資有限公司 代表人：温士昆	1,416,942	3.5	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	佶元投資(股)公司	負責人	—
川匯(股)公司 代表人：陳舜耕	901,911	2.23	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亞特控制系統(股)公司 代表人：丘于川	1,070721	2.64	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	194,000	0.48	—	—	—	—	—
佶元投資(股)公司 代表人：温士昆	1,031,536	2.55	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	富啟投資有限公司	負責人	—

九、 公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114 年 12 月 31 日；單位：股；%

轉投資事業名稱	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
VisionWealth Global Co., Ltd	289	100%	—	—	289	100%
上海創崴醫療器械有限公司	註	100%	—	—	註	100%

註：非為股份有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份

單位：仟股；新臺幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
107.08	10	8,500	85,000	5,986	59,860	資本公積轉增資 10,590 仟元,盈餘轉增資 10,590 仟元	—	註 1
108.01	12	8,500	85,000	7,213	72,130	員工認股權轉換 12,270 仟元	—	註 2
108.07	12	8,500	85,000	7,261	72,610	員工認股權轉換 480 仟元	—	註 3
109.06	10	8,500	85,000	7,624	76,240	盈餘轉增資 3,630 仟元	—	註 4
110.04	20	15,000	150,000	11,312	114,120	現金增資 36,880 仟元	—	註 5
110.07	10	30,000	300,000	15,000	150,000	盈餘轉增資 36,880 仟元	—	註 6
111.06	10	30,000	300,000	21,000	210,000	盈餘轉增資 60,000 仟元	—	註 7
112.07	10	30,000	300,000	21,667	216,670	員工認股權轉換 6,670 仟元	—	註 8
113.01	25	30,000	300,000	27,667	276,670	現金增資 60,000 仟元	—	註 9
113.08	10	60,000	600,000	29,000	290,000	員工認股權轉換 13,330 仟元	—	註 10
113.10	15	60,000	600,000	30,000	300,000	員工認股權轉換 10,000 仟元	—	註 11
114.02	65	60,000	600,000	36,280	362,799	現金增資 62,799 仟元	—	註 12
114.10	15	60,000	600,000	36,686	366,859	員工認股權轉換 4,060 千元	—	註 13
115.04	628	60,000	600,000	40,494	404,939	現金增資 38,080 仟元	—	註 14

註 1：變更登記日期文號：府授經商字第 10707418510 號
註 2：變更登記日期文號：府授經商字第 10807045840 號
註 3：變更登記日期文號：府授經商字第 10807357760 號
註 4：變更登記日期文號：府授經商字第 10907330930 號
註 5：變更登記日期文號：竹商字第 1100008771 號
註 6：變更登記日期文號：竹商字第 1100018596 號
註 7：變更登記日期文號：竹商字第 1110018853 號
註 8：變更登記日期文號：竹商字第 1120021903 號
註 9：變更登記日期文號：竹商字第 1140003115 號
註 10：變更登記日期文號：竹商字第 1140023831 號
註 11：變更登記日期文號：竹商字第 1140033867 號
註 12：變更登記日期文號：竹商字第 1150006393 號
註 13：變更登記日期文號：經授商字第 11430834350 號
註 14：變更登記日期文號登記中

115 年 4 月 30 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	40,493,911	19,506,089	60,000,000	數上櫃股票

2. 經核准以總括申報制度募集發行有價證券之資訊：無。

(二) 主要股東名單

持股比例達 5%以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

115 年 3 月 27 日；單位：股；%

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
義大利商 Technoprobe S.p.A.	3,400,000	8.4
薩摩亞商 YQ Technology Company Limited	3,400,000	8.4
銳邑科技股份有限公司	3,382,813	8.35
幔利實業有限公司	2,711,244	6.7
力晶創新投資控股（股）公司	2,675,000	6.61
SBI＆PSMC JV Fund LP	1,665,000	4.11
富啟投資有限公司	1,416,942	3.5
川匯股份有限公司	901,911	2.23
亞特控制系統股份有限公司	1,070,721	2.64
佶元投資股份有限公司	1,031,536	2.55
合計	21,655,167	53.49

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

前項應分派之股息及紅利、資本公積及法定盈餘公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。其中股東紅利之分配得以現金或股票方式發放。

盈餘分派之金額、股利種類及比率，得視當年度實際獲利及營運狀況調整之，每年度就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息及紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2. 本年度擬(已)議股利分配情形

本公司於 115 年 3 月 10 日董事會通過 114 年度盈餘分派案，配發 183,429,555 元，並將提 115 年股東常會報告。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：未配發無償配股，故不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：本公司係依章程規定以當年度扣除分派員工酬勞及董事監察人酬勞前之稅前利益分別以不低於10%及不高於5%提撥員工酬勞及董事監察人酬勞。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司估列員工、董事及監察人酬勞金額係依公司章程規定之提撥成數計算估列，認列為薪資費用。如年度財務報告通過發布日後金額仍有變動則視為會計估計變動，調整次一年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司派發 114 年度員工酬勞 31,986 千元及董監酬勞 11,195 千元，與本公司認列費用並無差異之情事。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司並未以股票分派員工酬勞，故不適用。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

二、公司債辦理情形：無此情事。

三、特別股辦理情形：無此情事。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情事。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證種類	113 年 員工認股權憑證 發行及認股辦法	114 年第一次 員工認股權憑證 發行及認股辦法	114 年第一次 員工認股權憑證 發行及認股辦法
申報生效日期及總單位數	114 年 4 月 10 日； 500 單位	114 年 9 月 1 日；1,500 單位	114 年 9 月 1 日；1,500 單位
發行日期	113 年 9 月 26 日	114 年 9 月 2 日	114 年 11 月 13 日
存續期間	2 年	4 年	4 年
已發行單位數	500 單位	1,000 單位	500 單位
尚可發行單位數	-	500 單位	-
發行得認購股數占已發行股份總數比率	1.36%	2.73%	1.36%
得認股期間	自被授予員工認股權憑證屆滿 12 個月	自被授予員工認股權憑證屆滿 2 年	自被授予員工認股權憑證屆滿 2 年
履約方式	發行新股	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率(%)	自被授予員工認股權憑證屆滿 12 個月，可行使認股權比例 100%	自被授予員工認股權憑證屆滿 2 年，可行使認股權比例 50%；屆滿 3 年，可行使認股權比例 100%	自被授予員工認股權憑證屆滿 2 年，可行使認股權比例 50%；屆滿 3 年，可行使認股權比例 100%
已執行取得股數	406,000 股	0 股	0 股
已執行認股金額	6,090,000 元	0 元	0 元
未執行認股數量	38,000 股	1,000,000 股	500,000 股

未執行認股者其每股認購價格	15 元	417.7 元	386.8 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.10%	2.73%	1.36%
對股東權益影響	本次發行員工認股權憑證為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益；員工認股權轉換後將對股東權益造成一定之稀釋結果，顯示對股東權益並無重大不利之影響。	本次發行員工認股權憑證為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益；員工認股權轉換後對股東股權稀釋程度僅占已發行股份總數 2.73%，顯示對股東權益並無重大不利之影響。	本次發行員工認股權憑證為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益；員工認股權轉換後對股東股權稀釋程度僅占已發行股份總數 1.36%，顯示對股東權益並無重大不利之影響。

(二) 累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

	職稱	姓名	取得認股數量(千股)	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量(千股)	認股價格	認股金額(千元)	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量(千股)	認股價格	認股金額(千元)	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	吳智孟	393	1.07%	125	15	1,875	0.34%	268	15 417.7 386.8	95,714	0.73%
	副總經理	林俊忠										
	副總經理	張簡毅仁										
	副總經理	伍建仲										
	特助	吳政忠										
	協理	張琪琪										
	協理	黃琬婷										
	協理	張家榮										
員工	資深經理	潘○威	338	0.92%	84	15	1,260	0.23%	254	417.7 386.8	103,345.7	0.69%
	處長	楊○煌										
	處長	陳○全										
	處長	陳○睿										
	處長	蔡○昌										
	經理	吳○樺										
	經理	楊○弦										
	經理	戴○全										
	經理	顏○峰										

(三) 最近三年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：

本公司並無併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債之情事，最近三年度之現金增資皆已執行完成，茲就各次現金增資之計畫內容、執行情形及執行情形及產生之效益說明如下：

(一)115年現金增資發行新股

本次現金增資發行新股計劃已公告於公開資訊觀測站，請詳「投資專區」項下之「募資計劃執行專區」。

(二)113年度現金增資發行新股

1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：114 年 2 月 25 日竹商字第 1140006393 號。

(2)本次計畫所需資金總額：新臺幣 408,194 千元

(3)資金來源：現金增資新股 6,279,911 股，每股發行價格 65 元，募集資金總額為新臺幣 408,194 千元。

(4)計劃項目、資金運用進度：

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日	所需資金總額	預定資產金運用進度
			114年第一季
充實營運資金	114年第一季	408,194	408,194

(5)預計效益：

本次現金增資可增加資金靈活運用空間，更能強化財務結構，以因應未來營運規模擴充及業務成長所產生之資金需求，進而提升整體競爭力。

(6)變更計畫內容、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期：不適用。

(7)輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期：不適用

2.執行情形

單位：新臺幣千元

計畫項目	截至114年第一季執行情形			進度超前或落後情形、原因及改善計畫
充實營運資金	支用金額	預定	408,194	已依計劃進度執行完畢。
		實際	408,194	
	執行進度(%)	預定	100%	
		實際	100%	

3.執行效益分析

單位：新臺幣千元

項目		113年底(募資前)	募資後預估數
基本財務資料	流動資產	723,760	1,131,954
	流動負債	248,150	248,150
	負債總額	261,430	261,430
	營業收入	406,017	406,017
	利息支出	76	79
財務結構(%)	負債比率	29.42%	20.16%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	492.00%	805.65%
償債能力(%)	流動比率	291.66%	456.16%
	速動比率	264.03%	428.53%

資料來源：113 年底經會計師查核之財務報告。

如上表所述，本公司募資後之負債比率由 29.42%下降至 20.16%，惟長期資金占不動產、廠房及設備比率由 492.00%上升至 805.65%，主要係因現金增資後長期

資金增加，另流動比率 291.66%上升至 456.16%，速動比率由 264.03%上升至 428.53%。本公司整體財務結構及償債能力獲得改善，顯示充實營運資金之效益應屬良好。

(三)112年度現金增資發行新股

1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：113 年 1 月 22 日竹商字第 1130003115 號。

(2)本次計畫所需資金總額：新臺幣 150,000 千元

(3)資金來源：現金增資新股 6,000,000 股，每股發行價格 25 元，募集資金總額為新臺幣 150,000 千元。

(4)計劃項目、資金運用進度：

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日	所需資金總額	預定資產金運用進度
			113年第一季
充實營運資金	113年第一季	150,000	150,000

(5)預計效益：

本次現金增資可增加資金靈活運用空間，更能強化財務結構，以因應未來營運規模擴充及業務成長所產生之資金需求，進而提升整體競爭力。

(6)變更計畫內容、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期期，並應刊載輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期：不適用

(7)輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期：不適用

2.執行情形

單位：新臺幣千元

計畫項目	截至113年第一季 執行情形			進度超前或落後情形、原因及改善計畫
充實營運資金	支用金額	預定	150,000	已依計劃進度執行完畢。
		實際	150,000	
	執行進度(%)	預定	100%	
		實際	100%	

3.執行效益分析

單位：新臺幣千元

項目		111年底 (募資前)	112年底 (募資後)
基本財務資料	流動資產	268,261	319,587
	流動負債	97,482	86,886
	負債總額	101,488	87,980
	營業收入	158,221	120,383
	利息支出	189	109
	每股盈餘（元）	0.4	(2.33)
財務結構(%)	負債比率	25.43%	18.12%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	290.61%	275.67%
償債能力(%)	流動比率	275.19%	367.82%

項目		111年底 (募資前)	112年底 (募資後)
	速動比率	189.20%	319.04%

資料來源：經會計師查核之財務報告。

如上表所述，本公司募資後之負債比率由 25.43%下降至 18.12%，惟長期資金占不動產、廠房及設備比率些為下降，主要係因產線需求增加機器設備，另流動比率 275.19%上升至 367.82%，速動比率由 189.20%上升至 319.04%。本公司整體財務結構及償債能力獲得改善，顯示充實營運資金之效益應屬良好。

（三）本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項：不適用。

（四）本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

（五）本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、營運概況

一、 業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營之主要內容

依經濟部登記之所營資料記載如下：

A. CB01010 機械設備製造業

B. CB01990 其他機械製造業

C. CE01030 光學儀器製造業

D. CQ01010 模具製造業

E. E604010 機械安裝業

F. E603050 自動控制設備工程業

G. F601010 智慧財產權業

H. F401010 國際貿易業

I. CC01080 電子零組件製造業

研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：

①半導體探針卡相關製程設備及產品

②Mini/Micro LED 切割、巨量移轉、檢測等相關製程設備及產品

③5G散熱模組相關製程設備及產品

2. 主要產品營業比重

單位：新臺幣仟元；%

主要產品	112 年度		113 年度		114 年度	
	營業收入	比重(%)	營業收入	比重(%)	營業收入	比重(%)
半導體自動化設備	109,018	90.56	378,422	93.20	703,784	98.26
其他	11,365	9.44	27,595	6.80	12,449	1.74
合計	120,383	100.00	406,017	100.00	716,233	100.00

資料來源：本公司經會計師查核之財務報告。

3. 公司目前之商品(服務)項目

本公司主要從事半導自動化設備開發、製造及銷售業務，目前主要產品為MEMS探針卡自動化設備（包括自動植針、檢測、鑽孔、返修…等設備），同時開始進行MEMS 探針卡代理銷售業務與規畫整卡自動化返修服務。另外 IC FT 測試段亦投入PoGo Pin Test Socket 之自動化檢測、植 pin 及檢測設備開發、製造及銷售。模組類產品主要以應用於晶片先進封裝市場之高密度銅柱端子模組為主。

4. 計畫開發之新商品(服務)

A. MEMS探針卡相關商品與服務

全球半導體探針卡產業在 AI、先進製程與先進封裝等驅動下，2025年度展現出強勁的復甦與擴張態勢，高效能運算（HPC）晶片及 AI 應用加速非記憶體晶片測試的升級。邏輯晶片（如 CPU、GPU、ASIC 與 SoC）測試密度、頻率與功耗等要求日益提高，導致非記憶體探針卡技術面臨全面升級，尤以 MEMS 與高密度接點探針卡成為市場關鍵解決方案，有鑑於此，公司首先於2025年中開展MEMS探針卡

代理銷售業務，並於第四季陸續開發完成全自動化返修整線相關設備，接續通過國際探針卡大廠Technoprobe驗證，開始進行銷售；第二階段規劃於2026年第一季至第二季開始建置整線自動化返修產線，並通過終端客戶驗證，預期可於2026年第三季展開自動化產線維修代工服務，包含：

①MEMS垂直式探針卡(Probe Card)及MEMS探針(Probe Head)代理銷售

②MEMS垂直式探針卡全自動化維修設備

③MEMS垂直式探針卡全自動化維修代工服務

B. 先進封裝銅柱端子模組

①銅柱玻璃通孔基板TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)

②面板級封裝(Panel Level Package)銅柱玻璃基板(Cu Pillar on Glass, COG)

5. 主要產品之應用領域

產業		本公司產品與服務項目	客戶群
半導體	Probe Card 探針卡（Chip Probe）	MEMS 探針卡相關自動化設備： ● 自動化植針設備 ● 整體自動化製造設備解決方案 ● 整體自動化維修設備解決方案	探針卡製造廠
		● MEMS 垂直式探針卡及探針代理銷售 ● MEMS 垂直式探針卡全自動化維修服務	IC 設計廠 晶圓代工廠
	Test Socket 測試座(Final Test)	High Pin Count Pogo pin 自動化植針、檢測、返修設備	封測廠 測試座製造廠 AI 晶片 IC 設計廠
精密自動化設備		2.5D、3D 封裝載板自動化檢測與雷射返修設備	封測廠
		精密光學 LiDAR MEMS Mirros 自動組裝&檢測設備	光學雷達製造廠
		車用 Mini LED 自動化檢測與雷射返修設備	LED 廠
		手持式電子產品載板精密飛針碰焊設備	手持式消費性電子品牌廠
高密度銅柱端子模組		● SiP、Double Side 雙面封裝高密度銅柱端子模組(WiFI 模組、 TDD 模組、天線模組） ● Power Module 高密度銅柱端子 ● 銅柱玻璃通孔基板 TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar) ● 面板級封裝(Panel Level Package)銅柱玻璃基板(Cu Pillar on Glass, COG)	封測廠

(二) 產業概況

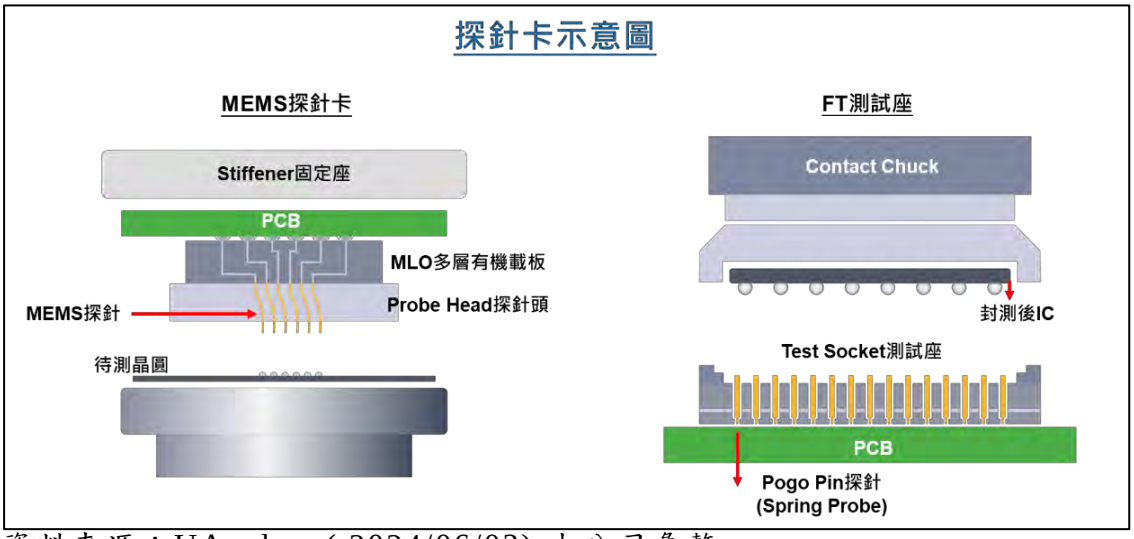
1. 產業之現況與發展

A.半導體探針卡產業發展趨勢

半導體產業鏈上游為 IC 設計業，中游為 IC 晶圓製造，下游為 IC 封裝測試。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠製作成晶圓半成品，晶圓代工廠製作完成晶圓產品後，將會進行前段晶圓測試，之後再將受測後晶圓委交專業封裝廠進行晶圓切割並予以封

裝，最終再經由測試廠進行最終後段測試後包裝出貨。

半導體測試是半導體製造過程中的重要環節，通過使用專業測試設備和技術，對半導體晶片、晶圓及封裝後的器件進行電氣性能、功能特性等方面的檢測，以確保產品符合設計要求和品質標準。其貫穿於半導體製造的前道、中道和後道環節，包括設計驗證（Product Design）、晶圓測試（CP）、晶片成品測試（FT）等階段。IC 測試則可分為兩階段，一是進入封裝之前的晶圓測試（CP），主要測試晶片上晶粒的電性。另一則為 IC 封裝成為成品後的測試，主要在測試 IC 功能、電性與散熱是否正常，以確保品質。探針卡測試則為晶圓製造與晶片封裝的重要節點，可以直接影響晶片良率及製造成本，對於半導體產業具有重要意義。探針卡在晶圓測試（CP）階段，對晶片上的每個晶粒進行針測；測試座則是最終測試階段（FT）的測試卡，主要針對封裝腳位 I/O Pin 的點位進行接觸測試。下圖針對晶圓級 CP MEMS 探針卡以及 IC 封裝後 FT 測試探針測試座（socket）的結構做分析：



資料來源：UAnalyze(2024/06/03);本公司彙整

探針卡（Probe Card）是一片佈滿探針的精密測試結構，為測試機台和待測晶圓間測試分析的重要介面；每一種類型的 IC 都需要針對其規格、腳位、特性需求製作出相對應之探針卡。探針卡的工作原理係藉由設置於探針卡上的探針（probe needles）與待測晶片（Devices Under Test，DUT）上的銲墊（pad）或凸塊（bump）接觸進行針測（Probe test），輸入及輸出晶片訊號以進行電性量測，再配合周邊測試儀器與軟體控制達到自動化量測。

以 MEMS 探針卡為例，其主要以探針頭（Probe Head），由探針及陶瓷卡組成，中間則是 MLO 多層有機載板中介層連結到下層的 PCB 電路板，最後則是由固定座將整張探針卡予以固定。晶圓製作完成後，需要透過探針卡測試晶圓品質，檢測出品質優良、或不良（瑕疵或故障）的 IC；後續製程中，將汰除品質不良的 IC，而只有品質優良的 IC 進入後續的封裝階段。

晶圓經過探針卡針測之後，再切割成獨立的晶粒，再將合格的晶粒繼續進到後段 IC 封裝製程進行封裝，以保護晶粒免於受損並提升電性連接與散熱效果。基於晶粒封裝的成本在整體 IC 生產上佔比較高，尤其高階先進封裝製程不斷衍進，高度集成化、薄型化、高功能及低功耗封裝逐漸為各家晶片廠所採用，未來高階封裝的成本勢必提高，因此減少構裝浪費的半導體晶圓探針卡檢測技術已經成為 IC 產業中重要的環節。

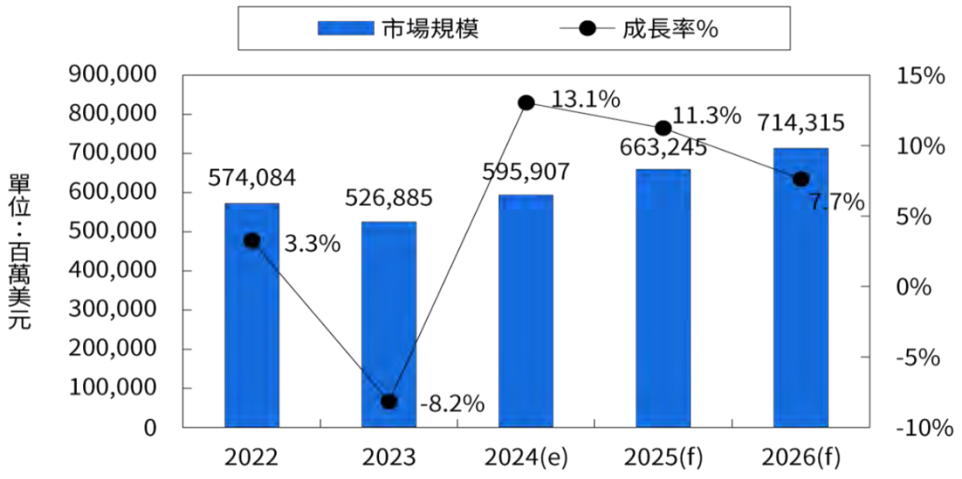
Final Test 則是 IC 經過封裝後須測試 IC 運作是否正常，包含檢查電流、電壓

等規格；另外還包含系統級測試（System Level Test），主要為結合軟體檢查 IC 主要功能以及最終的老化測試（Burn-in Test），在高溫環境下進行相關的信賴性測試。FT 測試的探針卡結構主要是由 Pogo Pin 彈簧針接觸元件、同軸測試座以及 PCB 電路板組成，同樣的在 IC 最終的構裝後以探針卡上的探針（Spring Probe）與待測 IC 封裝上的銲墊（pad）或凸塊（bump）接觸進行針測（Probe test），輸入及輸出晶片訊號以進行電性量測，再配合周邊測試儀器與軟體控制達到自動化量測。

近年來隨著 SoC 和微處理器設備的倒裝芯片如 HBM、AI GPU、ASIC、Controller IC 等產品晶圓製程及封裝技術進步，帶動 IC I/O 數大幅提升，並縮小 pad 間距；FT 測試亦隨著先進封裝發展逐漸往超高 pin count 數以及探針尺寸微縮的趨勢前進，因此 IC 晶圓測試與封裝後最終測試的高精度、高密度探針卡及測試座需求重要性日益提高。

由於晶圓探針卡與半導體產業發展趨勢緊密相連，半導體市場的興衰將影響晶圓探針卡發展的趨勢走向。根據工研院產科國際所調查報告資料（2024/05），2023 年全球半導體市場規模為 5,269 億美元，年衰退 8.296%，主要為全球經濟疲軟，終端市場低迷，晶片供過於求導致庫存增加、價格下降，晶圓廠產能利用率表現不如以往，特別是記憶體產業出現了大幅度的衰退，導致 2023 年全球半導體市場呈現衰退態勢。過渡到 2024 年，隨著全球通貨膨脹趨緩，終端市場買氣回升，復以人工智慧（AI）等新興應用需求興起，帶動伺服器、電腦、智慧手機等相關電子產品升級，半導體產業開始進入景氣復甦階段，預估全年市場規模可達近 5,960 億美元，年成長率 13.1%。

預測 2025 年，終端市場持續復甦以及受惠於 Generative AI 帶動，短期資料中心相關 AI 半導體需求強勁，長期則受惠於 AI PC、AI 智慧型手機、邊緣端應用需求大增的情況下，預期半導體產業將表現持續正向成長趨勢，預估 2025 年市場規模可達 6,632 億美元，年成長率 11.3%。更預測在 2026 年，年成長率可達 7.7%，並帶動推升全球市場規模上看 7,143 億美元。



資料來源：工研院產科國際所(2024/05),本公司彙整

B.半導體探針卡產品產業發展趨勢

探針卡主要應用於 DRAM、NAND Flash、CIS、CPU、GPU、FPGA、射頻晶片、類比晶片等各類晶片的晶圓測試環節。不同類型的晶片由於其功能、性能、引腳數量和佈局等方面的差異，對探針卡的要求也各不相同。例如，對於高性能的 CPU 和 GPU 晶片，由於其引腳數量多、測試信號複雜，需要使用高密度、高精度的探針卡；而對於一些簡單的類比晶片，對探針卡的要求相對較低。由於每一種晶片的引腳排列、尺寸、間距變化、頻率變化、測試電流、測試機台有所不同，針對不同的晶片都需要有定制化的探針卡。探針卡具有高複雜性、高精密型、高定制化等特點，其根據晶圓測試的需要在極其有限的面積內裝配大量探針，從數百至數萬支探針，這些探針一方面需要保持精確的水平度與正位度外還要保證探針裝配的一致性、 精準性，倘若針位偏移或探針損壞均會影響探針卡的可靠性並對待測晶圓產生損傷。

探針卡測試為半導體晶圓測試不可或缺的重要環節與關鍵產品，其零組件探針頭、載板、PCB 需要高度整合，技術門檻高且專利佈局完善，主要供應商佔據大部分市場份額，其餘為眾多小型業者。

從產品結構來看，探針卡產品主要分為 MEMS 探針卡（微機電探針卡）、垂直探針卡、懸臂探針卡 等。傳統懸臂式探針卡技術門檻低、探針 pin 數較少，主要應用於 DDIC 產品，競爭十分激烈；而垂直式探針卡、微機電探針卡主要用於先進製程半導體裝置所需之測試解決方案，由於具有極高的準確性、可重複性且無變異性，主要用於測試細間距凸點晶圓以及 SoC 和微處理器的倒裝芯片如 HBM、AI GPU、ASIC、Controller IC 等產品。其中，MEMS 探針卡具有精密度高、測試效率高、耐用性強、穩定性好等優勢， 為目前高階高性能晶片的主流產品。

探針卡技術類型分類

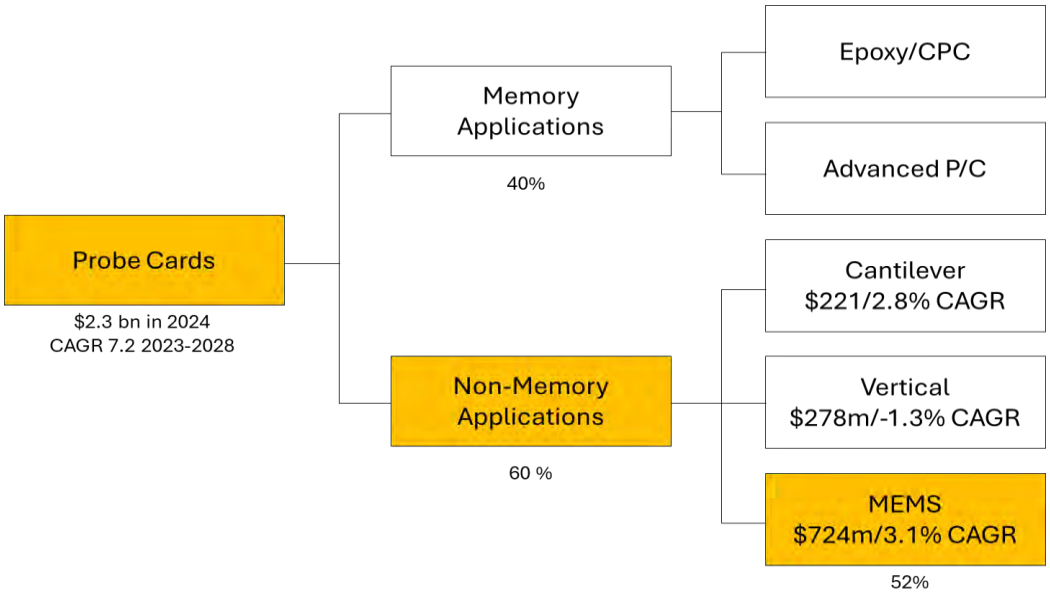
探針卡分類	應用	優勢	劣勢
懸臂式探針卡（Cantilever）	使用金屬探針懸臂接觸晶圓，技術門檻較低，探針數量較少。主要用於傳統晶片， 驅動 IC（DDIC）、小型邏輯 IC。	製造成本低，適合大規模量產產品。	精度有限。隨著晶片 I/O 數量增加，CPC 探針卡的適用性降低，逐步被 VPC 及 MEMS 替代。
垂直式探針卡（Vertical）	探針排列垂直，適用於高密度 I/O 晶片測試，訊號傳輸更穩定。多用於記憶體、邏輯晶片如 HPC、GPU、AI 伺服器晶片。	支援高針腳數測試，訊號損失較低，適合高階半導體製程。	製造成本較高，技術門檻較高，研發週期長。
微機電（MEMS）探針卡	微機電系統技術，適用先進制程，精度高、壽命長。應用於 AI ASIC、高速記憶體（HBM）、車用晶片。	可實現極小間距與高精度測試；具有高精度、高耐用性、高溫測試能力。	製造成本高，生產技術門檻高，目前市場競爭者較少。

資料來源：本公司整理

根據 Techinsight 資料顯示，2023 年全球探針卡市值約為 21.09 億美元（-17.0%YoY），記憶體市場約為 8.26 億美元（+2.6%YoY），非記憶體市場約為 12.70 億美元美元（-26.1%YoY）。從應用面觀察，系統單晶片 SoC、CPU、GPU 等邏輯類運算晶片為主要市場，2023 年佔非記憶體探針卡市場約 40~50%；記憶體市場中，仍以 DRAM 為主流，約佔 60~65%。

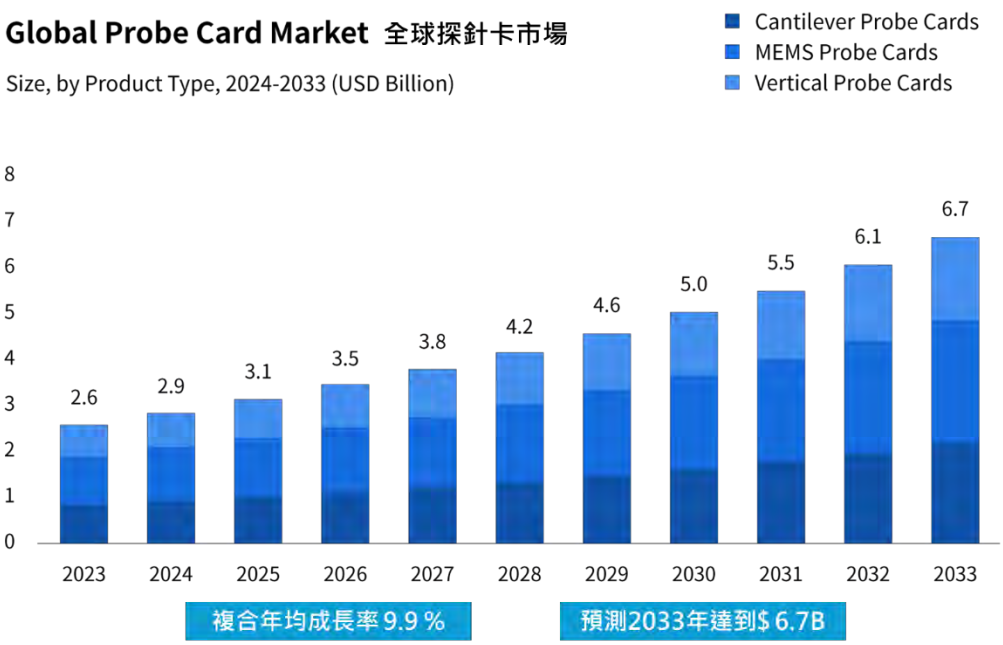
2023 年全球非記憶體探針卡中，以產品類別觀察，懸臂式探針卡（Cantilever ProbeCards, CPC）市值達 2.07 億美元（-14.3%YoY）、垂直式探針卡（Vertical Probe Cards, VPC）達 2.76 億美元（-23.5%YoY）、微機電探針卡（Micro Electro Mechanical Systems, MEMS) 達 6.62 億美元（-17.0%YoY），其中微機電探針卡漸成主流，佔比超過非記憶體探針卡五成。

根據 Techinsight 預估，2024/2025 年全球探針卡市值約為 22.98/25.46 億美元（+9.0%YoY/+10.8%YoY），記憶體探針卡市值約為 9.27/11.66 億美元（+12.2%YoY/+25.8%YoY）。非記憶體探針卡市值約為 13.60/13.67 億美元（+7.1%YoY/+0.6%YoY），其中 2024 年 MEMS 探針卡達 7.24 億美元，占比超過 52%。預估 2024~2028 年整體探針卡市場 CAGR+10.1%，記憶體/非記憶體市場 CAGR+13.2%/+2.6%。



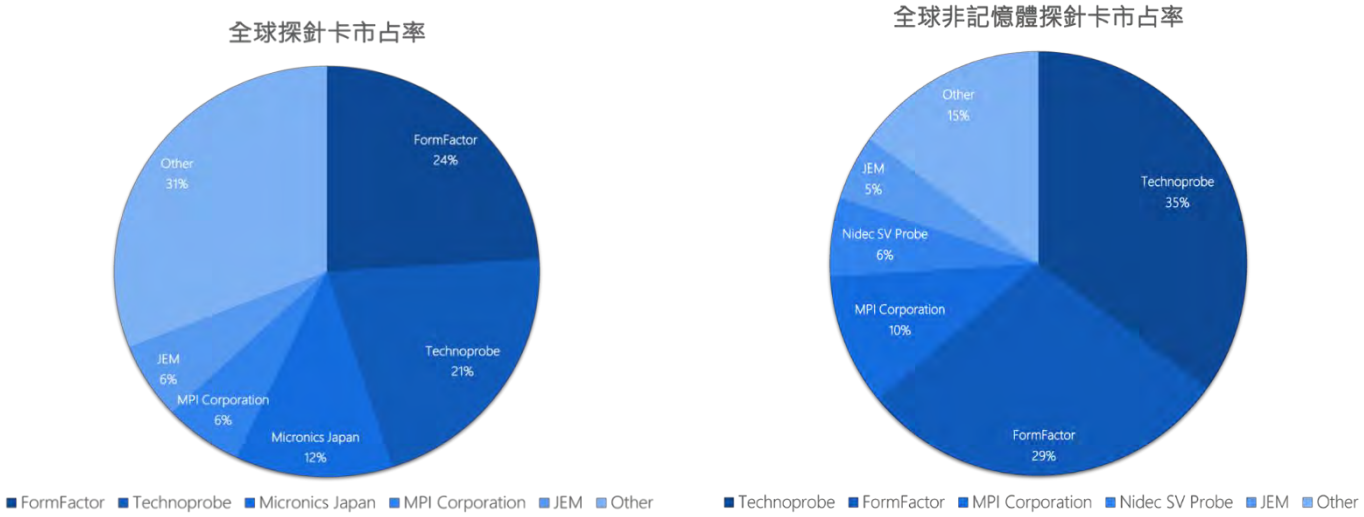
資料來源：Techinsight(2024/12)，本公司彙整

從區域性分析，Maket.US（2024/10） 資料顯示在 2023 年，亞太地區（APAC）則佔據了全球探針卡市場的主導地位，市場份額超過 38.9%，產值達到 10 億美元。進一步從長期趨勢分析，Maket.US 提供了半導體晶圓探針卡未來十年的成長預估，在 2024 年至 2033 年的預測期內，複合增長率（CAGR）為 9.9%，2033 年市值將樂觀預期成長到約 67 億美元。



資料來源：Market.US Report(2024/10) ，本公司整理

在廠商競爭面，2025 年產業結構呈現高度集中，根據 TechInsights（2025a）統計，全球探針卡市佔前兩大廠商為美國的 FormFactor（24%）與義大利的 Technoprobe（21%），合計佔近半數市場。台灣的旺矽（MPI）與其他亞洲廠商則積極推進 MEMS、高頻與高針數探針卡布局，企圖於先進應用領域提升市佔率與競爭力（TechInsights, 2025a）。



資料來源：Techinsight(2024/12,2025a)，本公司彙整

C. MEMS 探針卡發展趨勢

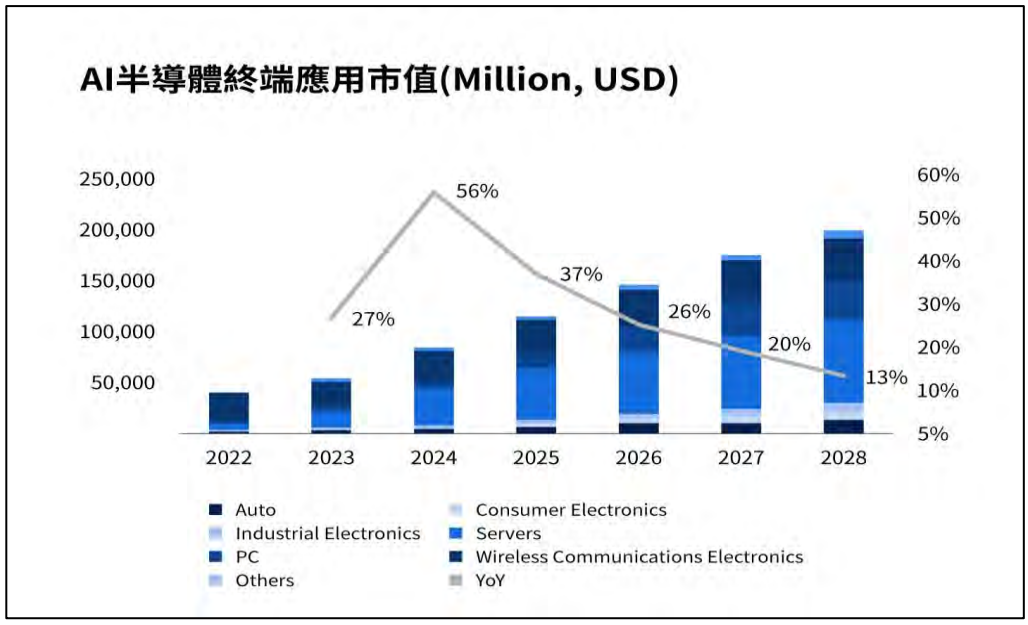
MEMS（微機電系統）探針卡作為半導體測試領域中的核心元件之一，其市場和技術發展深受半導體行業整體進步的驅動，主要用於測試細間距凸點晶圓以及 SoC 和微處理器設備的倒裝芯片頂級 AI/HPC、先進封裝、HBM、AI GPU、ASIC、Controller IC 等產品，綜合分析未來 MEMS 探針卡的成長主要受下列原因驅動：

(A)先進製程技術演進及晶片微縮，帶動 IC I/O 數增加

半導體技術發展隨著 IC 設計複雜度提升，以及半導體製程、封裝技術日益演進。由於晶片製程持續微縮，從 12nm 進步至 7nm 以下，甚至達未來 2nm 及 A16 製程，加上後段封裝由傳統覆晶封裝，提升至晶圓級封裝（Wafer Level Chip ScalePackage，WLCSP）、2.5D/3D 應用等，探針卡的結構設計複雜度及針腳數（Pin count）提升、mini. pitch 及 pad size 微縮（40um/25um）、更高的精度和複雜度以及 MEMS 針的高強度要求，將增加對高密度、高性能 MEMS 探針卡的需求增加。

(B)AI Server 市場爆發，帶動半導體測試需求提升

隨著 AI 伺服器與高效能運算（HPC）市場快速成長，美國、歐洲和韓國的半導體製造商正在加快擴產，對測試設備與探針卡的需求同步增加。Gartner 資料顯示，2024/2025 年全 AI 半導體市值將成長為 840/1159 億美元（+56.3%YoY/+36.8%YoY）。主因則是受惠於生成式 AI 相關晶片需求帶動，短期資料中心相關 AI 半導體需求將仍供不應求，中長期則預測 AI PC、AI 智慧型手機、邊緣端（Edge AI）需求將大幅興起，預估 2028 年 AI 半導體市值可達 1965.5 億美元，2023~2028 年 CAGR +29.6%。



資料來源：Techinsight(2024/12)，公司彙整

此外，2025 年度國際 CSP（雲端服務供應商）如 Amazon、Google、Microsoft、Meta 為了減少成本並降低對 NVDA 依賴，持續擴增資本支出，建置 AI 資料中心，AI ASIC 開案持續開出；加上各國主權 AI 相繼抬頭、浮現下一波 AI ASIC 晶片強大需求。

由於 AI 晶片普遍採用高單價的先進封裝技術，KGD（Known Good Die）的重要性不言而喻，這些晶片需要複雜的測試解決方案並採用高性能之探針卡。因此預其將會更進一步帶動微機電（MEMS）高階探針卡出貨。

(C)5G 及 IoT 物聯網

5G 和 6G 技術推動高頻、高性能晶片的測試需求增加，MEMS 探針卡需支持更高頻率測試以因應 5G 網路的高速擴展；同時物聯網設備（IoT 設備）的加速普及將帶動對低功耗、高可靠性晶片的測試需求。

(D)汽車電子

電動汽車（EV）與自駕技術的普及將推動對功率半導體和感測器等高性能計算晶片的測試需求，亦將進一步將推動高端探針卡市場的發展。

台灣晶圓代工、封裝與測試產業持續成長且穩坐全球之冠，伴隨先進晶圓製造與封測技術、規模領先全球，上下游產業鏈成熟且持續擴大投資，結合 AI、HPC 應用興起，台灣擁有絕佳開發先進 IC 測試探針卡相關技術之產業環境。創新服務過去十年以來深耕 MEMS 探針卡自動化植針及相關自動化技術並提供全球非記憶體探針卡廠商自動化植針設備與代工服務，成功在 7nm 晶圓製程以下之先進 MEMS 探針卡市場獲得全球晶圓大廠全面導入自動化植針設備，同時亦獲全球非記憶體 MEMS 探針卡大廠投資與策略合作，無論是探針卡自動植針技術、產能、市佔排名，亦或整卡全自動化相關設備均維持在全球設備市場之領先地位、後續除了持續與全球最大晶圓代工廠與全球最大 MEMS Probe Card 廠的緊密合作與策略結盟外，經營策略將注重在研發投入及技術創新性，力求以更高階的技術開發以持續帶動成長動能，以保有在 MEMS 探針卡市場之競爭優勢。

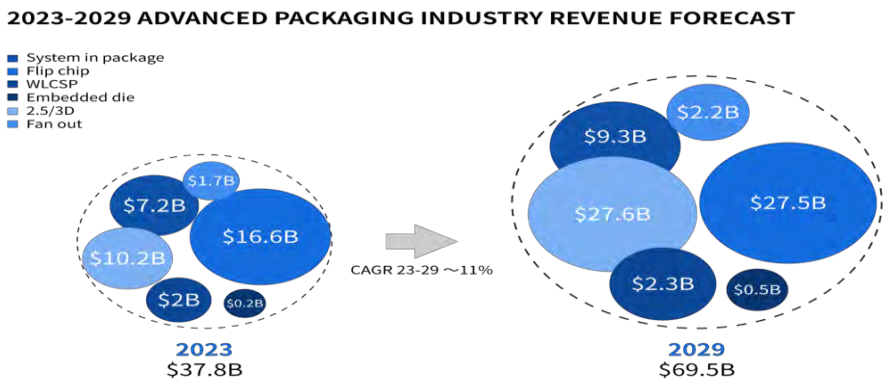
D.先進封裝產業銅柱連結（Cu Pillar Pin Interconnection）發展趨勢

(A)產業趨勢

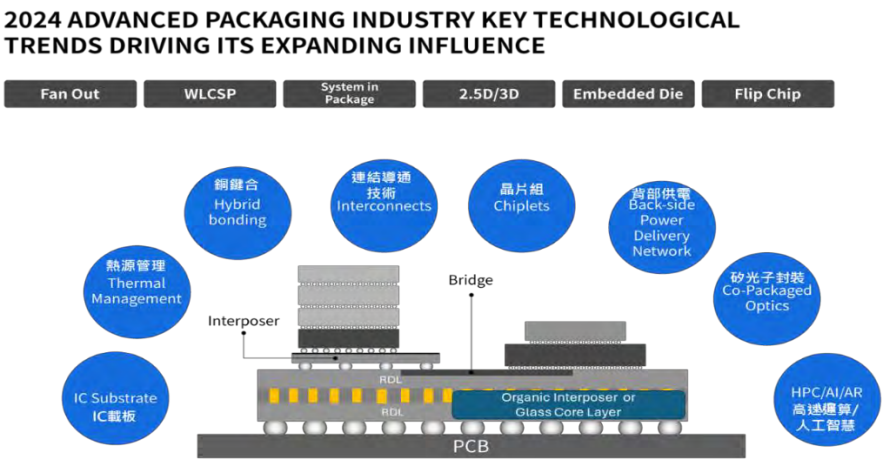
在 2023 年經歷調整後，先進封裝市場在 2024 年復蘇並持續增長。先進封裝的各個子市場，包括倒裝芯片（Flip-Chip）、系統級封裝（SiP）、扇出型封裝（Fan Out）、晶圓級芯片尺寸封裝（WLCSP）、嵌入式芯片（Embedded Die）以及 2.5D/3D 封裝，均呈現出正增長，推動著先進封裝行業向前發展。

Yole 市調顯示先進封裝（AP, Advanced Packaging）市場預計在 2023 年至 2029 年間以 11%的年複合增長率（CAGR）增長。預計到 2029 年先進封裝市場規模將會達到 695 億美元。

2023 年，先進封裝約佔整個集成電路封裝市場的 44%，並且由於各種大趨勢，如 AI（人工智能）、HPC（高性能計算）、Automotive（汽車）和 AIPC（人工智能個人電腦），其市場份額正在穩步上升。



資料來源：Yole (2024/07)，本公司彙整



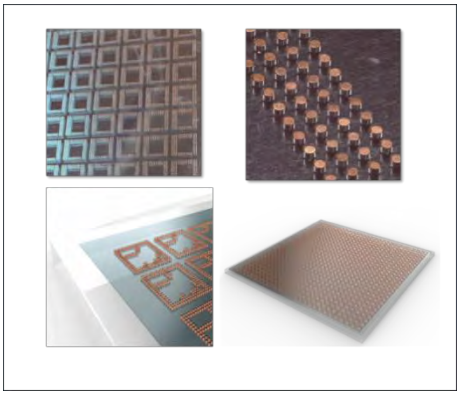
資料來源：Yole (2024/07)，本公司彙整

(B)主要優勢

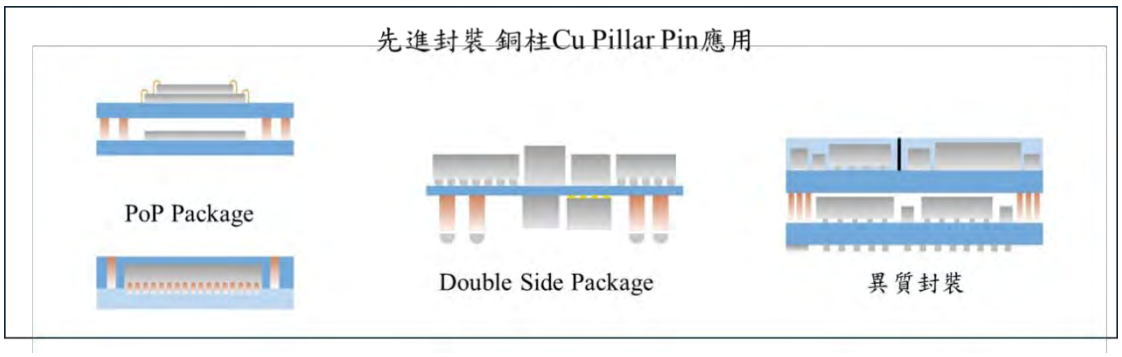
銅柱連結導通技術（Cu Pillar Pin Interconnects）因其優異的電氣和散熱性能首先在 2023 年及 2024 年開始應用於先進封裝的 SiP（System in Package）、雙面立體封裝、異質封裝以及立體封裝。其中因空間高度之需求需在立體封裝中整合更多元件並以垂直通電取代橫向電力訊號傳輸以減少傳輸損號，高深寬比的導通連結銅柱開始逐漸取代傳統的錫球載板堆疊（Solder Bump Frame Board）技術和電鍍銅技術（Cu Plating）以換取更高的立體空間高度及更微縮的 I/O 腳位與布局（Lay Out），藉以形成更為 compact、更多元件整合以及最短導通路徑和更加的散熱表現，致使銅柱連結技術開始成為先進封裝的主流互連方案的重要選項之一。

其主要優勢包括：

- I/O 密度：相比於錫球、銅柱可以實現更小的間距（fine pitch），滿足高密度互連需求。
- 更好的電氣性能：相比於錫球，銅的導電性優異，能減少信號損耗。
- 優異的熱性能：相比於錫球，銅的熱導率高，有助於散熱，適合高功率以及大電流 power 類封裝應用。
- 機械穩定性：相比於錫球，銅柱結構更堅固，能承受更高的機械應力。
- 相比電鍍銅：銅柱能達成能達成更高的深寬比封裝需求，結構穩固無孔隙、氣泡以及電鍍的化學製程汙染。



銅柱(Cu Pillar Pin)在PCB Substrate以及Glass Substrate的應用



資料來源：本公司整理

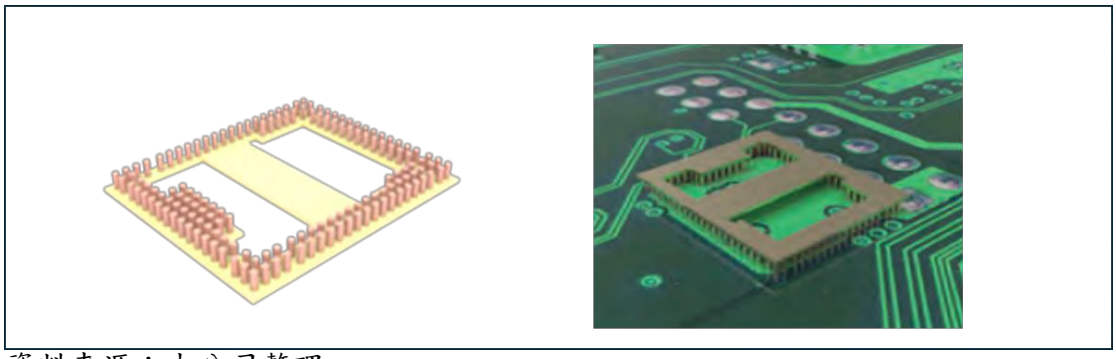
(C)銅柱端子模組優勢

銅柱產品尺寸微小，現階段直徑最小可達 60um，高度可達 3mm 以上，可依照封裝實際需求進行設計與製造。銅柱材料熱膨脹係數 17.7（10^{-6}/K），熱傳導係數 380（W/mK），導電率 99%，遠優於傳統導通之錫球焊料方案。

傳統導入銅柱移植於 PCB 載板僅能使用打件一次轉移單針銅柱，面對 high pin count 數的 Cu Pillar Pin 移植需求，除無法滿足生產效率且經由打件移植後於後段迴焊爐製程無法確保每根銅柱之正位度與平面度，更甚者出現漏失 pin 以及倒 pin 等不良，嚴重影響終端成品良率。為確保在載板上單一晶片上的銅柱在移植過程中不出現傾倒、missing pin 及缺 pin 的情況，使用暫態高密度銅柱端子基板形式，將銅柱以巨量移轉方式快速高效的依照所需之 pattern 一次性移植至端子模組上；並透過可熱黏膠等方式予以固定，以形成一具有高密度銅柱的基板，最終再經過視覺檢測、補針、裁切、全檢，再以載帶或 Tray 盤包裝出貨。

封裝廠於封裝製程前段可先採用既有打件（SMT）技術將每一顆高密度銅柱端子移植到載板再進行 reflow 製程，如此將可確保所有銅柱最終移植到載板的良率與效率，reflow 製成後可利用清洗製程解黏移除暫態基板或利用研磨整平製程將暫態基板移除以完成高密度銅柱數量的移植，整體製程相較傳統打件移植銅柱，在先進封裝製程中更能有效掌控每根銅柱的移植良率，並能確保最終封裝良率與品質。

銅柱(Cu Pillar Pin)高密度端子模組示意圖



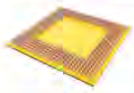
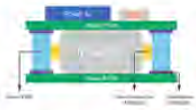
資料來源：本公司整理

(D)銅柱產品主要應用領域：

未來包含手持式消費性電子產品如智能手機、手錶、眼鏡中的 SiP

模組、 WiFI 模組、毫米波天線模組、AI 伺服器所需的電源管理模組(整合電源管理晶片、元件以及電感)；2.5D、3D 封裝基板中的 core layer 核心層皆是銅柱高密度端子技術與產品應用的範疇。透過銅柱優異的導熱導電性能以及高密度互聯優勢，可在先進封裝中實現更小間距、更高深寬比、提升異質材料集成密度以及熱管理與可靠性，進一步更可在 3D 封裝基板上整合 TGV，以更佳的平面度、低翹曲以及訊號低耗損率優勢以取代現階段的 HDI 載板。

隨著高性能計算、AI、5G 通信和汽車電子等領域的快速發展，高密度銅柱互聯導通技術將繼續在先進封裝市場扮演關鍵角色，並將在未來成為主流封裝導通技術。

應用市場	圖示	銅柱優勢	說明
Cu Pillar Pin Grid Array 封裝		● 平面度佳 ● Reflow後錫球坍塌或空焊問題 ● 高密度IO，微間距	2.5D, 3D封裝由BGA改為Cu Pillar Array以銅柱陣列 取代BGA錫球，能有效提升訊號傳輸穩定度，並兼具更佳的熱傳導能力，滿足高密度、高效能的封裝需求。
異質整合封裝		● 可適用高深寬比設計(1:2~1:10) ● 平面度佳，導電度高，散熱佳	取代Frame Board導通限制，高導熱、高導電性和更為緊湊的封裝優勢可增加設計彈性與模組優勢。
Power module 封裝		● 高散熱性，高導電佳 ● 可對應高深寬比垂直導通結構(1:2~1:10) ● 適合整合電感，電源管理晶片等先進整合封裝	垂直銅柱導通整合電源模組設計方案可以因應更高深寬比的結構，並提升電源模組散熱、結構支撐力與導電效率，同時降低整體體積並提升可靠度。
Cu Pillar TGV		● 散熱佳、導電性佳 ● 高深寬比(1:8~1:10) ● 無TGV電鍍銅後玻璃結構強度低落問題	優化玻璃基板結合RDL製程，高深寬銅柱設計可維持高可靠度的導通品質，並兼顧微型化的封裝要求。

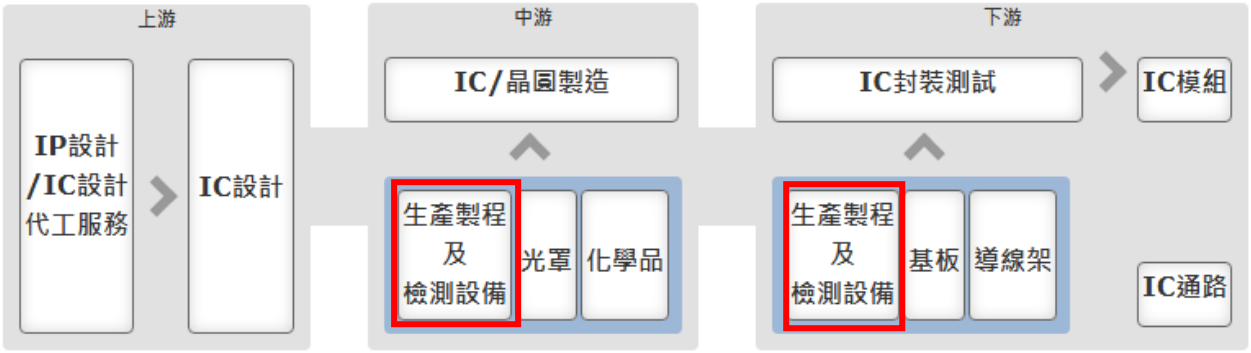
資料來源：本公司整理

未來包含掌上型消費性電子產品如智能手機、手錶、平板中的 SiP 模組、WiFI 模組、AI 晶片模組整合的電感 power module、2.5D、3D 封裝的中介層導通皆是銅柱高密度端子可應用的範疇。透過銅柱優異的導熱導電性能以及高密度互聯優勢，可在先進封裝中實現更小間距、更高深寬比、提升異質材料集成密度以及熱管理與可靠性。隨著高性能計算、AI、5G 通信和汽車電子等領域的快速發展，高密度銅柱互聯導通技術將繼續扮演關鍵角色，並在未來幾年內保持強勁增長。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司擁有完整的研發團隊，涵蓋精密機械、自動化科技、材料、軟體硬體、電子、資訊及光電等全方位的技術整合能力，可根據客戶需求量身打造解決方案，從影像處理到設備整機優化及整線自動化方案，滿足半導體客戶對各類高效能自動化設備之需求，成為精密半導體自動化設備整體解決方案提供者，屬於中游及下游之半導體製造設備廠商。

半導體上、中、下游產業關聯圖



資料來源：櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」

另本公司主要產品包括晶圓 MEMS 探針卡植針及相關設備、MEMS 探針卡自動化返修相關設備以及先進封裝高密度銅柱端子模組等。探針卡相關設備部分，由於精密設備中機械業加工過程複雜，所需零組件數量眾多，故於生產過程中部分零件加工係由協力廠商負責製造。就其所屬行業上下游關聯情形觀之，本公司研發、設計組裝並銷售各式晶圓探針卡相關設備予半導體晶圓測試廠及探針卡廠等產業之下游廠商，而上游則為零組件及原料供應體系，包括 PCB、探針、顯微鏡、精密自動化控制元件與視覺系統等供應商。

自動化返修代工部分，須借助公司自行開發專用高精密自動化設備輔助檢修，故本公司由上游取得精密探針卡相關材料，再由本公司使用自動化設備進行整卡檢測與修復，下游則是返還檢修後的探針卡給下游 IC 產業客戶或探針卡客戶。

先進封裝高密度銅柱端子模組部分，則由公司利用自行研發之專用生產設備並組立後透過向上游元件及材料商採購關鍵材料，再以自行研製之專用自動化整線設備進行模組產品生產，最終販售至下游之封裝產業或 IC 設計及製造業。

茲將本公司主要產品相關之上、下游關聯性列示如下：

上、中、下游產業關聯圖

	上游	中游	下游
探針卡相關自動化設備 及 探針卡代理銷售 暨自動化返修	機械加工業 自動控制元件 量測儀器業 電腦設備業 光學元件 電子元件 PCB業	電腦 自動控制設備 測試治具與專用治具 探針卡材料 自動化專用維修及檢測設備	IC設計產業 IC製造產業 IC測試產業 探針卡產業
高密度銅柱端子模組	PCB業 微型加工材料業 化工合成膠材製造業	機械加工業 自動控制元件 量測儀器業 電腦設備業 光學元件 電子元件 PCB業	IC設計產業 IC製造產業 IC封裝產業

資料來源：本公司整理

3. 產品之各種發展趨勢

A. MEMS 探針卡自動植針機設備

隨著晶片性能的不斷發展，晶圓測試要求不斷提升，更為極端的電氣性能、顯著減小的接觸焊盤間距、不斷增加的接觸焊盤密度、更嚴苛的機械精度、更極限的工作溫度、 更緊湊的生產週期、同時測試多個晶片的高並行性以及更便捷的維修和維護等。為因應以上發展趨勢，半導體晶圓 MEMS 探針卡需適配更小間距、更精細的測試要求並進一步優化探針幾何設計。

現有 7 奈米製程以下的手機晶片、繪圖晶片、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等高階邏輯晶片線寬線距微縮到 60 微米以下，隨著晶片算力持續升級及尺寸往不斷縮小，IC 接合墊（bond pads）亦隨之微縮，使得 pad pitch（間距：兩個接合墊中心點距離）下降；探針卡的測試探針截面積尺寸以及探針間距也需縮短，使得針腳數增加，因此探針卡的探針及規格大小也必須跟進微型化趨勢，更為精密之探針卡需求應運而生。

公司過往與晶圓代工廠及 MEMS 探針卡廠之合作上，可觀察 2024 年高階 MEMS 探針卡平均針數（Pin Count）可介於 5~ 8 萬針，2025 年預測可達 7 萬針以上，2026 年更將衝上 10~15 萬針，凸顯探針卡針數增加的斜率越來越陡，且 Bump 間距也不斷微縮，讓整體測試難度增加。也由於針數提升，探針的重量及施加應力（Contact force）增加，探針設計難度也隨之增加。同時先進封裝趨勢使得 pad 設計往 Micro Bump 發展，因應不同設計，探針接觸設計也越來越多樣化。如此一來將增加自動化植針技術的挑戰，除了開發可因應微間距、同時需適用於不同款式 MEMS 探針外，兩款不同形式探針的自動植入以及更精密的探針尺寸、彎曲程度、水平度與正位度量測與自動拔針等需求，大幅提升了 MEMS 探針自動植針的技術門檻。

本公司已深耕十餘年半導體 MEMS 探針卡自動化植針技術，並透過與全球晶圓代工領導廠商之合作成功以自動化植針技術取代人工植針，並持續優化自動化植針及相關技術，現階段已可達成每日植針數超越 5000 pin，並且已於 2025 年第二季推出 Dual Arm MEMS 探針卡植針機，並開始量產銷售，最高可達成每日植針數超越 10000 pin 的目標，可望應用於邏輯式高階 MEMS 探針卡並可跨入記憶體 MEMS 探針卡應用。

MEMS 探針卡規格發展與創新植針機對應方案

晶圓廠製程	垂直 MESM 探針卡 pin count 數	垂直 MEMS 探針尺寸	探針卡節點間距	創新自動植針機 Capability
10nm	20,000	65x65um	60um	單 Arm 植針機（5,000 pin/day）
7nm	20,000~30,000	45x55um	40um	單 Arm 植針機（5,000 pin/day）
5nm	50,000~100,000	45x55um	40um	雙 Arm 植針機（10,000 pin/day）
3nm	50,000~150,000	30um~45um	20um	雙 Arm 植針機（10,000 pin/day）
2nm	100,000~	<30um	20um	雙 Arm 植針機（10,000 pin/day）

資料來源：本公司整理

B. MEMS 探針卡自動化返修設備

現階段半導體技術演進快速，客戶晶片目標一年一代，且持續採用新製程與新技術，導致測試系統與待測晶圓間的連接挑戰增加，常造成高階 MEMS 探針卡在嚴苛之電性、熱能、大電流環境下出現燒針、探針毀損、短路等異常造成不良率提升，且因高階 MEMS 探針卡維修難度升高勢將延長返修時間。為提升整卡出現異常之返修效率，MEMS 探針卡維修的製程急需以全自動化取代人工及部分半自動設備，以期大幅提升返修效率與品質管控，減少人工二次損害，包含探針卡回送返修所需的自動化全卡視覺檢測、探針卡探針自動換針、探針卡全卡自動雷射清潔、探針尖端自動雷射塑針、探針卡電性分析檢測等整線自動化設備，皆是未來 MEMS 探針卡全自動化的必要關鍵技術。

C. 高密度銅柱端子

本公司過去耕耘 MEMS 探針植針技術、Micro LED 巨量移轉技術、精密雷射加工技術，累積豐富微型元件加工以及組裝精密技術，因應高密度銅柱導通技術將於多元化先進封裝方案中獲得廣泛應用進而投入開發微銅柱巨量移轉技術並進而建置自製全自動化線生產技術，預期未來應用包括：

- 雙面封裝及立體基板封裝技術:面對多層構裝技術所需，POP 封裝、Double Side 封裝、SiP Interposer 封裝、AiP 封裝等產品應用於更 compact 微型化模組，應用在各式樣的手持式低功號裝置中的 WiFI 模組、天線模組、TDDI 模組中，Cu Pillar Pin 具有更易設計、更高密度以及更低功率損耗等優勢。

- 高功率電源管理晶片模組:電源管理模組例如 PMIC 應用中須高度整合電感、電阻、電容元件，採用更高寬深比的電源及訊號導通架構，同時兼顧大電流及高電性、高散熱性需求成為關鍵技術，可高達 1:10 以上高寬深比的銅柱元件可取代傳統 lead frame 導線架織架構提供更佳效能的垂直電源晶片導通方案。

- 2.5D/3D 封裝：在 2.5D/3D 封裝中，銅柱用於 Substrate 核心層(Core Layer)的垂直互連，巨量移轉金屬陣列銅柱，可完美匹 TGV 玻璃載板通孔，透過巨量轉移金屬陣列銅柱，將細銅針一次性、大量植入 TGV 通孔中，並以高可靠度膠體固定，用以取代傳統耗時的電鍍銅製程，避免電鍍孔洞產生的氣泡包封問題，也有效消除了銅針與玻璃直接接觸時的熱膨脹不匹配所造成玻璃裂紋等產品失效風險。可用以取代傳統容易受熱產生翹曲的高密度載板(HDI)以及耗時、易產生應力裂紋的玻璃通孔電鍍基板，以提供封裝基板中介層更佳的製造良率與效能。

- Panel Level Package(PLP)：銅柱導通技術未來在玻璃基板(PLP)製程中，針對垂直供電設計可望在導入電容等元件需增大垂直空間以利整合更多被動元件之需求下，引入銅柱巨轉技術已取代電鍍銅製程，實現高密度 I/O 以及高寬深比連結。

由於高密度銅柱端子在先進封裝中須先完成一次性的巨量移轉，在每個晶片內的微銅柱需求數量與體積大小隨著各終端應用不同而有所區別，從低 pin count 樹的 EMI 防護，到電源模組導通(<70 pins)，再到 SiP Interposer、WiFI、天線模組的連結，更進一步到 Pannel Level 等級或 TGV Core Layer 基板等級(數千至數萬 pin count)，銅柱移植技術皆須能滿足高效率、高良率以及高精度的移轉。本公司歷經三年已成功開發全產線自動化微銅柱移轉全自動化生產線，全線自動化設備皆由公司自行設計、開發、組裝，相關規格技術皆與下游台灣封裝大廠及 IC 晶片商共同合作，目前技術水平已達先進封裝產業之要求，皆已成功導入多款產品，預計可在 116 年度正式邁入量產。

先進封裝銅柱連結導通技術需求

銅柱產品應用	銅柱巨轉精度	銅柱尺寸 (直徑)	Cu Pillar Pin Count
SiP Interposer WiFI Module AiP Module	± 15um	Φ100 ~300um	< 300 pin
電源管理模組 Power Module	± 15um	Φ 200 ~500um	< 100 pin>
玻璃通孔核心基板 TGV Core Layer	± 5um	Φ 60 ~100um	1000 pin ~ 100,000 pin
面板級封裝 (Panel Level Package)	± 3um	Φ60 ~100um	1000 pin ~ 100,000 pin

資料來源：本公司整理

4. 競爭情形

A.探針卡自動化植針機設備與相關自動化返修設備

隨著晶圓製程邁入 5 奈米以下，先進封裝如 2.5D、3D IC 及 Chiplet 架構普遍化，使測試階段複雜度與精度大幅提升，進一步推升高階探針卡技術門檻與市場價值（TechInsights, 2025b），MEMS Probe Card 成為炙手可熱的需求，而在半導體晶圓代工廠需求推波助瀾下，超過全球 70%以上高階晶圓製程皆由台灣廠囊括，在此產業環境下，台灣晶圓代工廠引領主導與全球最大 MEMS 探針卡廠進行開發與合作，率先導入公司的全自動化 MEMS 探針植針技術和設備，進而建立了公司的技術領先優勢。爾後於 2023~2025 年間，全球其餘探針卡廠持續跟進，開始全面導取代人工植入方式的全自動化植針機設備。

MEMS 探針卡自動化植針目前為寡佔市場，技術門檻高且競爭廠家極少，我司為全球探針卡自動植針機製造領先廠商，目前僅少數探針卡廠商擁有自行研發之自動植針設備（如：美商福達電子股份有限公司（美商 FormFactor

分公司）、中華精測科技股份有限公司、義大利商 Technoprobe 集團等廠商），但在植針效率與功能上，本公司產品仍具有領先競爭優勢。

本公司為建立持續性競爭優勢，不斷投入研發能量，除了開發雙臂植針設備外，更開發全自動化探針卡微修整線設備取代傳統人工或半自動化生產方式以建立競爭優勢：

產品	創新全自動化返修設備 競爭優勢	業界競爭對手
Dual Arm MEMS 探針卡自動植針設備	1.自動化植針. Max. 10000 pin/day 2.IPQC 全程檢測 3.自動化智慧生產 4.累積超過 3 億根 MEMS 探針植針實績	1.人工植針 2.自動化設備植針 <5,000 pin/day
MEMS 探針卡 自動返修設備	1.全線自動化檢測、塑針、清潔、換針、插針 Total Solution 2.自動化智慧生產	人工維修/ 半自動化維修

B.半導體先進封裝高密度銅柱端子

本公司開發出可一次性將超過上萬根微型銅柱移轉至載板上之銅柱巨量移轉技術（Cu Pillar Pin Mass Transfer Technology），結合此巨量移轉技術，能實現全自動化微銅柱的精確定位與植入操作，另可根據不同產品需求進行彈性設計不同規格和尺寸的微銅柱端子模組，提升產品應用範疇；同時進一步透過研製專用生產設備，涵蓋巨轉、返修、視覺精密檢驗、裁切封裝等製程，開發出全球第一套全自動化生產之高密度銅柱端子模組生產線，可在不更動客戶既有生產流程下，使用高密度銅柱端子產品以既有元件打件黏著方式（SMT）將端子模組有效移轉至基板（Substrate）上，可有效維持銅柱的位置與水平精度，最終再經過迴焊爐製程後固定銅柱，再透過解膠製程或研磨製程將高密度銅柱端子的暫態載板移除，完成銅柱巨量移轉過程。

高密度銅柱端子模組的整廠生產設備為公司自行開發，並已申請相關發明及新型專利，同時與全球封裝領導廠商及終端消費性電子品牌及 IC 廠合作，在各種應用上已建立完整驗證報告，確認相較於現有產業常用錫球 frame board 堆疊技術具有競爭優勢，因此被列入未來先進封裝製程重要導入技術。

高密度銅柱端子產品現階段主要針對 SiP Interposer 封裝、雙面封裝及垂直導通電源管理模組封裝上需要實現微縮化、高深寬比、高導電性與散熱性應用做開發。目前公司已導入手持式消費性電子產品及 power 模組相關應用，相較於其他包含利用錫球製作的 Frame Board 以及常見的電鍍銅導通技術，採用巨量移轉技術的高密度銅柱端子具有以下的技術競爭優勢：

優勢比較	銅柱 （Cu Pillar Pin）	錫球 (Solder Bump Frame Board)	電鍍銅柱 (Cu Plating)
高散熱係數 高導電率	380k 99.9%	15K 80%	<350K 99.1%
高深寬比 (適合被動元件或 IC 多層堆疊異質封裝)	1:1.3~1:10 (可取代 Frame Board 及電鍍銅高度極限)	1:2	1:1
高密度 IO （Mini. PITCH）	160um	380um （⌀200um solder ball）	5um
平面度佳	<50um	<100um	<5um
位置精度 X Y SHIFT	TGV:±5 um Substrate: ±15um	> ±25umm	±2um
生產效率	直接上 SMD 或 Pannel shipping	直接上 SMD 或 Pannel shipping (錫球易坍塌)	需 3-4 小時 (高深寬比電鍍,易產生氣孔及包封)

資料來源：本公司整理

銅柱玻璃通孔基板 TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)部分，3D 先進封裝基板中的 TGV 核心基板（Through Glass Via Core Layer ）應用上可有效解決傳統大尺寸基板(HDI 核心)翹曲與高頻傳輸損耗問題，TGV 銅柱核心基板具備低介電常數（Low-DK），適用於高速通訊與 AI 晶片，具有高平坦度、高耐溫、低熱膨脹係數等優異特性，能克服大尺寸晶片因翹曲問題導致的性能瓶頸，亦可取代傳統耗時的金屬電鍍製程，避免電鍍孔洞產生的氣泡包封，與金屬、玻璃直接接觸時的熱膨脹不匹配所造成玻璃裂紋等問題。並實現的需求，預期可為先進封裝晶片提供低損耗、低翹曲、高可靠度與高效率生產的解決方案。

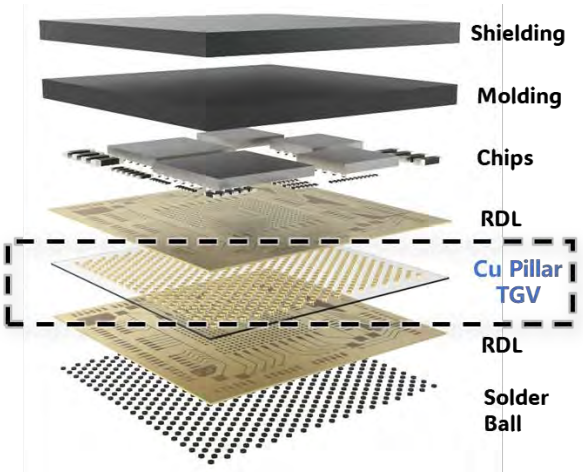
3D 封裝基板比較	銅柱玻璃通孔基板 TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)	電鍍玻璃通孔基板(Metal Plating TGV)	HDI 基板
導熱性	**≈400K**	≈400K	≈40K
導電性	**99.9%**	99.9%	99.1%
介電損耗	**低**	低	較高
耐熱衝擊 **(25°C←→300°C, 20/sec)**	**高**	低	低
平整度(抗翹曲)	**高**	高(易有裂紋)	低

金屬通孔導通	**高效率銅 pin 植入**	電鍍通孔 耗時	電鍍通孔 耗時
玻璃基板通孔 深寬比	**高**	中	中

資料來源：本公司整理

銅柱玻璃通孔基板 TGV-ICP

(Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)於 3D 封裝基板應用



資料來源：本公司整理

目前銅柱移轉技術主要競爭對手為日、韓設備廠商，說明如下：

同業廠商	競爭產品
日本 MINAMI CO.,LTD	1. 銅柱移轉設備及補針設備 2. 未能提供完整產線自動化方案與全線設備
韓國 KOSES CO.,LTD	1. 銅柱移轉設備及雷射焊接設備 2. 未能提供完整產線自動化方案與全線設備

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展概況

本公司係以研發為核心競爭優勢，著重服務客戶進行產業技術創新與成品發展，透過提供快速、高效率自動化 Total Solution 並搭配即時客戶服務與相關的應用 Know-how，以培養穩定的客戶合作關係。

本公司致力開發半導體先進製程之相關設備，目前編制 68 名研發人員，占本公司員工占比五成，現行研發部共有四處外，並額外設置高雄事業處、新產品事業處、工程技術處、探針卡開發事業處以支援產品開發測試及驗證、專利評估送樣取證等，並由總經理予以訂定其工作職掌及設定研發方向。為維持公司競爭力，本公司每年編列高額研發預算，為保護公司研發成果，本公司極力爭取專利保護。截至 115 年 1 月，本公司取得專利共計 59 項；目前審查中的專利共計 41 項，本公司取得及審查中專利整理如下：

利項目	已取得				審查中			
	發明	比率	新型	比率	發明	比率	新型	比率
半導體先進製程設備相關	15	34.88%	1	6.25%	6	15.00%	1	100.00%
先進封裝設備相關	14	32.56%	7	43.75%	24	60.00%	0	0.00%
其他	14	32.56%	8	50.00%	10	25.00%	0	0.00%
合計	43	100.00%	16	100.00%	40	100.00%	1	100.00%

由上圖所示，本公司爭取專利之主要項目分三大項，分別為半導體先進製程設備相關、先進封裝設備相關及其他。半導體先進製程設備相關主要係以植針機相關，早期製程以人工植針即可滿足產能，惟現行因先進製程針對探針卡上之植針數量邁入高 pin count 數及待測點間距微小化趨勢，故衍生自動化植針的需求發明，並同時須兼具高效率植針及來料、植針過程以及植針結果全面品質檢驗之功能。

本公司就半導體先進製程領域主要研究方向係以精密植針、精密組裝與檢測為主，現行已取得 15 項發明專利、1 項新型專利，占本公司已取得的專利為 27.12%；先進封裝設設備相關主要為銅柱巨量移轉設備與模組開發，本公司看好先進封裝未來需求暢旺，故於最近兩年積極開發銅柱移轉之相關製程設備與模組成品，占本公司已取得的專利為 35.59%，並且積極佈局相關製程與結構專利，目前本公司審查中專利有五成以上均為先進封裝領域相關產品。其他專利主要為雷射設備與散熱裝置相關專利，主要係因應半導體先進製程設備雷射鑽孔、切割、微加工等相關核心技術與散熱裝置技術布局所需。除申請專利保護公司之產品與技術外，佔據本公司重要核心技術之一的軟體技術，公司專門設置軟體研發部門統籌，為保護自身之智慧財產權，有關程式開發均有專人保管且限制讀取。

綜上所述，現已取得 59 項專利；41 項專利待審核中，足已顯見本公司研發能量足夠，其中以發明專利占取具專利之比重最大，可以有效維持本公司之產業技術領先優勢。

2. 研究發展人員與其學經歷

單位：人；%

年度 學歷	113 年度		114 年度		115 年 1 月 31 日	
	人數	%	人數	%	人數	%
博、碩士	15	27.78%	25	36.23%	25	36.76%
大專、大學	36	66.67%	41	59.43%	40	58.83%
高中(含)以下	3	5.55%	3	4.34%	3	4.41%
合計	54	100.00%	69	100.00%	68	100.00%

3. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用	79,086	85,186	82,370	108,646	154,341
營業收入淨額	286,776	163,879	120,383	406,017	716,233
研發費用占營業收入淨額之比例	27.58%	51.98%	68.42%	26.76%	21.55%

資料來源：本公司經會計師查核之財務報告。

4. 最近五年度開發成功之技術或產品

年度	產品	產品說明
110 年	皮秒雷射精密加工設備	1. 優化雷射光學系統設計，顯著提升雷射為加工精度與效率。 2. 針對半導體先進製程加工所需，可有效控制熱累積，防止材料因過熱而變質，確保加工穩定性。
111 年	銅柱巨量移轉技術	針對先進製程封裝，可提供取代單一元件移轉之技術，透過微流道與微整列技術與精密 AOI 和感應元件控制，可將不同深寬比需求的銅柱體一次性短時間內大量移載至載板，並可精確控制銅柱體的移載精度與良率。
112 年	探針卡 Dual Arm MEM 探針自動植針技術	創新性探針整列與植針技術，支持雙臂平行自動化植針操作。
113 年	先進封裝高密度銅柱端子 WiFI 模組	採用巨量移轉設備進行高密度銅柱移轉，依據不同先進封裝需求可形成具備不同尺寸微形銅柱體在暫態基板之高密度銅柱端子模組，最終在進行 SMD 製程固定及暫態基板解離的製程後完成巨量銅柱體的移轉過程。
114 年	● 推出 Dual Arm MEMS 探針卡自動植針設備 ● 開始代理銷售 MEMS 探針卡及探針材料 ● 推出 MEMS 探針卡自動化維修整線設備 ● 推出探針自動篩選整列設備 ● 開發 MEMS 探針卡雷射鑽孔設備 ● 推出 3D 封裝基板 FT 自動化植針、檢測設備 ● 推出精密自動化銅箔飛針碰焊設備 ● 推出手術器械滑輪導線自動化組裝焊接設備	1. MEMS 探針卡部分：邁入整線自動化生產及返修整線設備代工服務。 2. 開始代理銷售 Technoprobe 探針卡產品。 3. Final Test Pogo pin 自動植針及檢測設備開發完成。 4. 相關精密自動化設備開發完成：精密飛針碰焊設備、MEMS Mirror 自動化組裝檢測設備和手術器械市場精密雷射焊接組裝設備開發完成。 5. 銅柱端子模組：成功開發電源模組、毫米波天線模組、TDDI 模組；TGV 銅柱基板模組已於第四季開發完成送樣。

年度	產品	產品說明
	● 推出 LiDAR MEMES Mirror 自動化組裝檢測設備 ● 推出先進封裝高寬深比銅柱電源模組 ● 推出先進封裝銅柱天線模組 ● 推出銅柱封裝銅柱 TDDI 模組 ● 開發先進封裝 TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)銅柱玻璃通孔基板。	
115 年度迄今	● MEMS 探針自動雷射塑針設備	使用自動化精密雷射進行超精密細微加工，針對 MEMS 探針進行塑形及修復。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

A.生產策略

(A)研發創新：持續投入產品創新研發，特別是在製程技術和核心設備的開發上，以確保技術領先地位。

(B)品質管理：強化品管流程，提升產品的一致性和可靠性。

(C)積極拓展探針卡產業及先進封裝產業之市場。

B.行銷策略

(A)積極爭取增加 1st Tier 的世界級客戶：1st Tier 客戶為產業技術的先驅者，透過與國際大廠的合作與開發可突破技術瓶頸，並藉由終端客戶嚴苛高品質之要求，藉以推動公司技術升級和營運擴展。

(B)展會參與：參加產業相關的國際展會，藉由展示新產品和技術來提升公司品牌的能見度與國際知名度。

C.經營管理

(A)資源整合與流程優化：強化公司內部 ERP 系統，從客戶接單、存貨、採購、生產到出貨等一連串作業，加強內部資源整合，提升組織效率，對生產流程進行持續的優化，使研發到生產無縫銜接，降低成本、縮短交期。

(B)強化分析管理報表：提供管理階層及時性、正確性的資料分析，協助其經營管理；及早發覺公司面臨的潛在問題或機會，以即時判斷應採取的行動決策。

(C)持續招募優秀人才：為加速拓展核心技術與產品推廣，持續招募合適人才並配套完善人才訓練、考核與留才制度，以因應各產品線快速擴增及健全服務國際 1st Tier 大廠所需。

2. 中、長期業務發展計畫

A.生產策略

(A)技術研究持續投入：在技術研究上持續投入，以持續提高產品品質，保持市場領導地位。生產線部分，因應探針卡整線自動化業務以及先進封裝高密度端子模組逐漸進入試產量及量產所需，及早根據實際客戶生產需求規畫足夠產能之產線配置及後勤維修體系，並建置全自動化及智慧化生產線以提高生產效率、有效控制生產成本與嚴格管控品質。

(B)建立穩定供應鏈夥伴關係：與供應商建立長期夥伴關係，透過定期稽核制度評核供應商以提高零件品質和供應穩定性。

B.行銷策略

(A)整體解決方案：整合客戶需求，提供更為先進之整體解決方案，滿足客戶在設備和技術服務上的全面需求。

(B)擴展規模：透過策略結盟方式擴展產品和客戶基礎，逐步擴大公司營運規模，深化與重要客戶之技術合作，進一步增加市場占有率。

(C)產業合作：與上下游廠商合作，進行市場共創，發展新產品和開發新市場並及早布局建立進入障礙。

C.經營管理

(A)建立合理有效之獎酬制度：提高核心人才向心力並建立激勵制度;重視人才並制定培育訓練計畫以避免人才流失。

(B)創新技術獎勵：建立技術獎勵機制，鼓勵員工創新，並進行智慧財產權的策略佈局，保護公司研發成果。

(C)發展國際業務：在美、日、歐等國家積極發展半導體產業供應鏈在地化的趨勢下，培養海外市場團隊，積極招募國際人才，開發新地區的業務版圖，拓展全球市場。

(D)建立優良企業文化：打造有凝聚力和積極向上的企業文化，促進員工的長期發展，增強企業競爭力。

二、 市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元；%

年度 銷售地區	112 年度		113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
臺灣	44,945	37.34	237,420	58.47	463,900	64.77
中國	58,715	48.77	154,064	37.95	33,232	4.64
美國	16,723	13.89	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	14,533	3.58	197	0.03
日本	-	-	-	-	2,227	0.31

越南	-	-	-	-	751	0.10
義大利	-	-	-	-	215,926	30.15
合　　計	120,383	100.00	406,017	100.00	716,233	100.00

2. 市場占有率

本公司主要商品之銷售地區以臺灣為主，其他銷售地區也擴及中國、日本、越南、馬來西亞。目前客戶涵蓋國內外主要的探針卡製造商、晶圓代工廠商(Foundry)與封裝測試廠(OSAT)。由於本公司產品多屬高度客製化之先進技術所需自動化設備及模組產品，量化基礎不一，目前第三方機構較少單獨出具統計資料，但依據公司實際出貨客戶以及市場調查，本公司主要產品皆為最先進技術市場所需之專業客製化產品，在業界皆居於領先地位並與客戶深化綁定合作，伴隨客戶技術發展與量產計畫所需逐漸提高供應數量並穩健成長。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

A.需求方面

臺灣產業聚落完整，上下游供應鏈完善，是台灣半導體業的競爭優勢。在 IC 構裝體積日漸縮小，構裝成本提高的趨勢下，晶圓針測已是 IC 製程中重要關鍵的一環，故晶圓探針卡需求量與 IC 製造量之間有一定相互關係。

臺灣晶圓代工業位居全球第一，台灣封測業亦佔據全球首位，IC 設計業居全球第 2，僅次於美國；半導體產業聚落完整已然是台灣半導體業的競爭優勢。封測業與 IC 製造、IC 設計業同步成長，都是驅動台灣半導體產業不斷成長的動能。由於探針卡主要應用於晶圓良率檢測，其最重要的功能，是在晶片進入昂貴且不可逆的切割與先進封裝製程之前，就預先篩選出有瑕疵的「壞晶粒」（bad die）。考量到一顆高階晶片的成本高昂，這種在製造前期的品質控制所能挽回的潛在損失，其價值已不可同日而語。為避免將有瑕疵的晶片投入後續昂貴的製程，正是探針卡為半導體製造商創造巨大經濟效益的關鍵所在 2025 年，全球半導體探針卡產業在 AI、先進製程與先進封裝等驅動下，展現出強勁的復甦與擴張態勢。根據 TechInsights（2025a）預估，全球探針卡市場總值將達 25.46 億美元，連續兩年成長，年增率達 10.8%。此一成長趨勢主要來自兩大面向：一為記憶體需求復甦與高頻測試需求擴大，二為高效能運算（HPC）晶片及 AI 應用加速非記憶體晶片測試的升級（TechInsights, 2025a；Technavio, 2025）。而隨著高階 AI/HPC 高效能晶片設計越益複雜，更加重半導體產業對於先進探針卡的品質與數量之需求，進而帶動高階的 MEMS 探針卡及其相關材料、測試與自動化設備發展。先進封裝產業方面，亦同樣會隨著整體產業發展以及完善的產業群聚效應發酵，不論在 2.5D、3D 封裝或 CoWos、異質整合封裝和 SiP 模組封裝的技術群聚效應下，可以預見未來在銅柱通聯結技術市場的高需求性與成長性。

B.供給方面

全球探針卡市場高度競爭，各探針卡廠商有其專精擅長的產品技術與合作的客戶，本公司 MEMS 探針卡植針及其他自動化相關設備上已建立領先全球

的競爭力與擁有厚實的客戶基礎，目前全球主要探針卡大廠及全球晶圓代工領導廠商多與本公司有業務往來，創新服務駐足台灣、除可就近提供台灣半導體產業鏈相關技術服務外，亦已開展探針卡整卡及探針卡材料包的代理銷售業務，隨著114年底自動化返修設備陸續到位(包含自動檢測、塑針、清潔、換針及自動探針篩選)，將立即建置自動化售後返修服務，提供客戶快速即時的自動化返修代工服務。

4. 競爭利基

A. AI影像辨識與分析

本公司具備先進的光學影像系統與視覺AI影像辨識技術，在機器視覺領域，公司自行研發AI演算法進行模型訓練、調校與優化，並能針對客戶指定之需求，進行快速精準辨識與定位，可顯著提升辨識準確度；此外亦可支援3D影像建模技術，實現即時監控以達成更精密的產品檢測與品質控制。

B. 台灣地利優勢 服務客戶創新

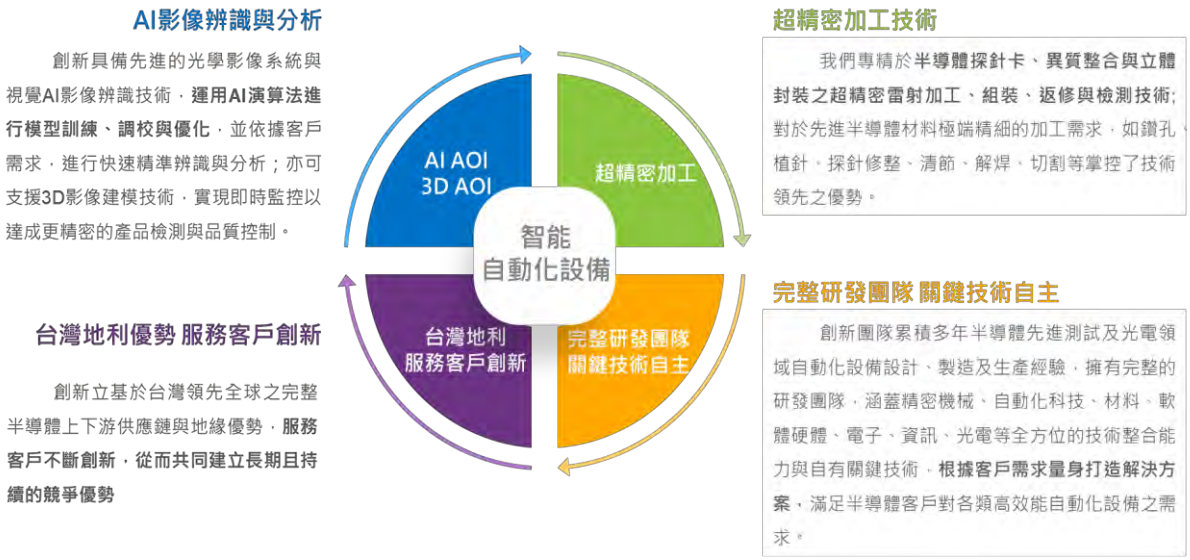
本公司立基於台灣領先全球之完整半導體上下游供應鏈與地緣優勢，不僅能迅速取得先進的技術與關鍵材料，更能因應全球市場需求的快速變化，提供客戶高度靈活且具成本效益的解決方案。透過與客戶的緊密合作，協助客戶不斷創新，從而共同建立長期且持續的競爭優勢，協助客戶在全球市場建立領先優勢。

C. 超精密加工技術

本公司專精於半導體探針卡、異質整合與立體封裝之超精密加工、組裝、返修與檢測技術，包含高精密自動化組裝；飛秒、皮秒雷射加工以及微元件巨量移轉及材料等技術應用；對於先進半導體材料極精細的加工需求，如鑽孔、植針、探針修整、清潔、解焊、切割等掌控關鍵技術know-how。

D. 完整研發團隊 關鍵技術自主

本公司團隊累積多年半導體先進測試、異質封裝及光電領域自動化設備設計、製造及生產經驗，擁有完整的研發團隊，涵蓋精密機械、自動化科技、材料、軟體硬體、電子、資訊、光電等。全方位的技術整合力與掌握自有關鍵技術，可快速根據客戶需求量身打造解決方案，從影像處理到設備整機優化及整線自動化方案, 融合了AI、光學檢測與精密加工技術，滿足半導體客戶對各類高效能自動化設備之需求。



資料來源：本公司整理

5. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

A.有利因素

(A)半導體高精密探針卡及先進封裝市場持續高度發展、產業進入門檻高、自動化程度發展空間大

隨著 AI 與大語言模型（LLM）推動資料中心與邊緣運算需求大增，進而帶動包括 HBM3、DDR5 與 GDDR6 等記憶體類型的產能擴張，測試需求同步升溫（TechInsights, 2025a）。此外，邏輯晶片（如 CPU、GPU、ASIC 與 SoC）測試密度、頻率與功耗等要求日益提高，導致非記憶體探針卡技術面臨全面升級，尤以 MEMS 與高密度接點探針卡成為市場關鍵解決方案（TechInsights, 2025b）。這為 MEMS 探針卡行業帶來了重要的成長機會。由於高階晶片所需之 MEMS 探針卡市場屬於高技術障礙與寡佔市場，一旦建立技術競爭優勢並形成穩固之策略結盟，並再結合我司自動化技術之優勢與國際探針卡公司的策略結盟，可望發揮綜效，創造有利之發展局勢。

(B)擁有研發自主之開發團隊

公司多年來專注投入先進技術開發，堅持自主研發核心技術並培養自有研發團隊，由於戰略上一直與國際大廠保持合作關係，伴隨客戶領先技術開發而成長，淬鍊出厚實的研發基礎與高效的研發團隊，基於公司擁有自主研發的 AI 影像辨識與分析技術，並整合了過往建立的光學、影像處理、精密機械、自動控制、軟體等各領域專長，建構了公司穩固的核心競爭力。綜觀公司 114 年度研發成果，相較過往數年具明顯之成長，在探針卡市場布局，已幾乎全面完成探針卡自動化設備線全方位產線解決方案；在先進封裝產品上，更將銅柱產品擴大到先進封裝各項應用，涵蓋微型 WiFI 模組、天線模組、電源模組、TDDI 模組及 TGV 銅柱基板。這些技術與產品成果將替公司未來打造可期的發展與營收挹注。

B.不利因素

(A)銷貨集中

因本公司銷售之客戶對象為半導體或封測等國際大廠為主，而半導體產業擁有市場高度寡占的產業特性，客戶群銷售對象數量有限，且客戶受惠市場需求急遽增長，使我司亦而產生銷貨集中之情事。

因應對策：

針對銷貨集中部分，除了與既有客戶維持密切的交易及合作，以維護良好的關係外，並積極開發多元產品佈局，將產能及技術資源適度分散運用於開發其他利基型產品，啟動成長「三引擎」，以分散銷貨集中所帶來的風險。

(B)研發與驗證費用支出增加

面對晶圓測試介面成長需求，探針卡密度與複雜度倍增，相關應用設備與返修難度增加，為維持公司核心競爭力，預期會增加相關研發設備之技術投入、研發人員投入以及驗證所需之測試與材料費用投入，將增加總體研發成本。

因應對策：

①建立數位設計模擬系統，透過設計虛擬測試平台針對高精度設備關鍵製成動作及軟體進行模擬，減少實體反覆驗證測試的次數和成本。

②將研發與測試過程模組化，分階段進行驗證，將資源優先投放在高風險和高影響的部分，以減少無效的投入。

③與上游客戶合作進行聯合開發，透過共擔成本及風險，減少公司承擔的研發驗證費用。

(C)專業人才養成不易

本公司產品設計研發橫跨光學、機構、電子、軟體及演算法等領域，需提供客製化系統整合解決方案；惟隨產業技術快速迭代，研發設計之複雜度與即時性需求提升，專業人才培育需仰賴長期經驗累積，若補強不及，恐影響核心技術研發與市場開發進度。

因應對策：

本公司除透過強化內部員工訓練以外，亦積極招聘大專院校優秀人才縮短產學界間落差，並持續提升福利制度及薪資待遇，並以績效獎酬及股權長期激勵強化留才，以進一步凝聚向心力與提升穩定度；同時善用與客戶共同開發與產學合作提升研發動能、落實技術與經驗傳承；未來並透過上櫃提升公司能見度與雇主品牌，以擴大人才來源並確保研發與交付動能。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之用途

本公司研發生產及製造 MEMS 探針卡植針及相關自動化維修設備、精密加工及組裝設備以及先進封裝高密度銅柱端子模組，各產品主要功能及在各領域的應用如下：

產品項目	重要用途
Probe Card 探針卡相關應用設備： ● MEMS 探針卡自動植針設備 ● MEMS 探針卡自動雷射鑽孔設備 ● MEM 探針卡自動維修設備	1.由於傳統人工植針速度相對較慢、隨著探針卡上的針數量朝高密度與更微小化，改以自動化植針設備，進而可提高生產效率、準確度和穩定性。 2. MEMS探針卡隨測試點及間距微縮化，孔數大幅增加，需要更為精密之自動雷射鑽孔設備以大幅提升生產效率與精度。 3.由於MEMS探針卡精密度與性能要求提升，致使發生毀損及異常時耗費大量時間進行檢修，且多處工站仍使用人工或半自動方式檢修，針對未來MEMS探針卡需求大量提升，全自動化探針卡維修將成為市場之核心競爭優勢。
Test Socket 測試座相關應用設備： ● Pogo pin 自動化植針、檢測、返修設備	針對high pin count之AI晶片產品最終測試(FT)採用更為精密之測試卡設計與Pogo pin需求，亟需建立測試socket Pogo pin的快速視覺檢測並針對毀損針執行精確拔除並再植入。
高密度銅柱模組產品	先進封裝中的銅柱（Copper Pillar Pin）導通技術是現代半導體封裝的關鍵技術之一，特別是在SiP模組封裝、人工智慧（AI）、5G通信和汽車電子等領域中扮演重要角色，透過公司巨量移轉銅柱製程技術與高密度銅柱端子的產品，將高深寬比的銅柱Pin大量快速移植，可大幅提升先進封裝客戶之生產效率並提供更為優化之高導電性及散熱方案。產品可應用於微型化SiP、雙面封裝、異質整合封裝、玻璃面板封裝(PLP)以及TGV 基板上。
其他 ● 精密加工及組裝設備	因應光電及微機電產業大量製造以及產能快速爬升之需要，設計客製化的自動生產設備以提升客戶生產效率以及良率。

(2)主要產品之產製過程

本公司主要產品區分 MEMS 探針卡植針及相關自動化維修設備、精密加工及組裝設備、先進封裝高密度銅柱端子模組，產製過程區分為設備類與模組成品類：

自動化設備類

A.產品開發與設計

(A)產品開發與工程分析：根據客戶需求，進行功能需求分析與工程可行性研究，確保產品定位與最終產品符合客戶需求。

(B)確認產品功能與規格：明確設備的技術指標和具體功能需求，制定產品規格書。

(C)研發設計：包含機構設計（結構和零件設計）、電控設計（控制系統和配線）、軟體開發（控制軟體及使用者介面）、硬體設計（電子零件和電路板設計）。

B.設計確認：設計方案確定，進行模擬、原型測試，確認所有功能符合設計預期。

C.物料確認：確認所有所需零件和物料的來源、品質、供應商，確保物料按時到位並進行入料檢驗。

D.設備組裝

(A)機構組裝：根據機構設計進行設備機械部分的組裝。

(B)電控配線：進行設備內外的電控配線，確保電路安全及功能正常。

E.設備整合與測試

(A)安裝主機：安裝設備的核心處理主機及相關部件。

(B)PLC 與軟體功能設計導入：導入自動化控製系統控制器（PLC）及軟體，進行控制系統的配置與功能測試。

(C)調機及功能優化：根據實際需求調整機台性能，優化各項功能，確保符合設計要求。

F.調校與最終檢驗

(A)最終測試與調校：進行設備的整體功能測試及精度調校，確保設備處於最佳狀態。

(B)廠內檢驗及再優化：對整台設備進行全方位檢驗，修正問題並進行參數調整和優化。

(C)出廠檢驗：依據出廠檢驗標準，確保設備在出貨前滿足所有要求。

G.包裝出貨與售後服務

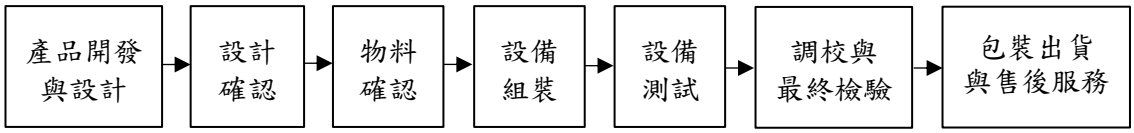
(A)客戶廠驗：設備送到客戶廠進行現場驗收，確保符合客戶需求。

(B)設備出貨：最終確定設備發貨，進行物流安排。

(C)教育訓練：對客戶提供設備操作和維護的教育訓練，確保其能有效使用設備。

(D)售後服務：提供客戶後續技術支援、維修服務和設備升級，以確保設備長期穩定運行。

自動化設備生產流程圖



高密度端子銅柱模組

A.模組產品開發與設計

(A)模組開發與工程分析：根據客戶需求，進行功能需求分析與工程可行性研究，確保產品功能與規格符合客戶需求。

(B)確認模組功能與規格：明確模組的技術指標和具體功能需求，制定產品規格書。

(C)研發設計：包含機構設計（結構和材料設計）及硬體設計（電子零件和基板設計）。

B.設計確認：設計方案確定，進行模擬、原型測試，確認所有功能符合設計預期。

C.物料確認：確認所有所需零件和物料的來源、品質、供應商，確保物料按時到位並進行入料檢驗。

D.模組生產

(A)基板製作：根據機構設計進行模組基板裁切與塗膠製程。

(B)巨量轉移：進行導電銅柱巨量移轉與檢測，確保銅柱端子成功移轉。

(C)視覺檢測：確保銅柱端子位置精度符合規格預期。

(D)固化封裝：進行模組膠體固化並包封

(E)模組裁切：使用精密雷射進行模組單顆裁切。

E.最終檢驗：進行切割後模組的最終視覺檢驗，確保規格符合客戶所需。

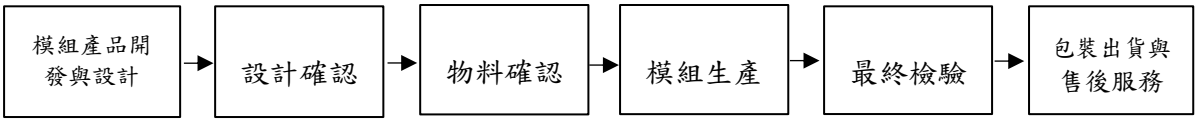
F.包裝出貨與售後服務

(A)包裝：模組進行自動化包裝作業，並進行包裝後外觀檢驗。

(B)出貨：最終確定產品發貨並提供出場檢驗報告，進行物流安排。

(C)售後服務：提供客戶後續技術支援、換修服務和客訴處理。

高密度銅柱端子生產流程圖



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料產品包含高精密雷射模組、自動化控制模組、馬達、視覺系統模組與元件，以及相關精密感測器等，主要原物料均有兩家以上供應商供應，以確保供貨之穩定性，本公司與主要原材料供應商亦建立了良好的合作關係，供應狀況未有異常之情事。

(四) 主要進、銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，暨增減變動原因

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	P11 廠商	12,325	13.61	無	TPI	70,565	24.08	關係人
2	P2 廠商	9,580	10.57	無	P11 廠商	18,353	6.26	無
3	-	-	-	無	P2 廠商	22,493	7.68	無
	其他	68,698	75.82		其他	181,614	61.98	
	進貨淨額	90,603	100.00		進貨淨額	293,025	100.00	

變動原因：

- P2 廠商、P11 廠商：本公司向該等供應商主要採購本公司自動植針機產品之原材料，114 年度對其採購金額顯著增加，主係自動植針機設備銷售狀況良好，故相關原材料採購同步增加所致。
- TPI：114 年度進貨增加，主因取具 TPI 產品銷售權並進行首次備貨所致。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，暨增減變動原因

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	S1 公司	135,954	33.48	無	TPI	215,926	30.15	關係人
2	S2 公司	127,564	31.42	無	特諾本	214,083	29.89	關係人
3	S11 公司	48,000	11.82	無	S11 公司	203,844	28.46	無
	其他	94,499	23.28		其他	82,380	11.50	
	銷貨淨額	406,017	100.00		銷貨淨額	716,233	100.00	

變動原因：

- S1 公司因有產線佈置之專案需求，故 113 年度對本公司訂單增加，惟 114 年度因專案結束故減少採購。
- S2 公司 112 及 113 年度因終端需求上升增加故訂單增加，114 年度尚有交易惟銷售占比低於本公司總銷貨淨額 10%
- TPI、特諾本、S11 公司因終端需求增加，加上本公司 MEMS 探針相關自動化設備產品效率佳，故訂單需求增加。

三、 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人

年度		113 年度	114 年度	115 年度 截至 3 月 31 日
員工人數	間接人員	88	122	123
	直接人員	10	16	22
	合計	98	138	145
平均年歲		35.6	36.6	36.59
平均服務年資		4.0	3.4	3.2
學歷分布比率	博士	-	-	-
	碩士	21%	27%	24%
	大學(專)	64%	59%	59%
	高中	12%	11%	14%
	高中以下	3%	3%	3%

四、 環保支出資訊

(一) 依法令規定，應申領汙染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納汙染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

本公司屬於組裝及系統整合生產模式，並無汙染廢液及製程廢水，故不適用本法規。

(二) 列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有汙染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。

(四) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、 勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

勞資和諧，為企業經營發展之原動力，本公司全體同仁本此共同理念，在互信、互助與互諒下，同心協力、攜手合作，建立了長久至今安定之工作環境與良好之企業文化，也促進了公司之不斷茁壯與成長，今後仍將延續保持下去，同時本公司亦將繼續推展下列各項工作，為創造更佳之經營績效，謀求公司股東與全體同仁之福祉而努力。

1. 員工福利措施

(1) 年終獎金、三節獎金、分紅獎金、績效獎金。

(2) 員工旅遊、員工餐廳、停車場及家庭日活動。

(3) 年度尾牙及健康檢查、午餐費補助及下午點心提供。

(4) 津貼及保險類-伙食津貼、團體保險。

(5) 依法提撥職工福利金、成立職工福利委員會，經辦各項職工福利活動，諸如：生育補助、年節禮券、婚喪喜慶補助、部門聚餐補助、員工特約商店等。

2. 進修及訓練

(1) 各單位於每年第四季提出下年度之「年度教育訓練計畫表」，經部門主管核准後，轉教育訓練單位後續追蹤。

(2) 年度教育訓練計畫來源：依據組織發展需求、公司短/中/長期策略、公司營業目標，作為培養人才與其發展性之訓練規劃方向。

(3) 年度教育訓練計畫課程項目須包含：職前訓練、通識訓練、專業訓練、環安訓練及主管訓練。

3. 退休制度與實施情形

本公司為規範員工退休管理及保障員工退休後生活，依照勞動基準法及勞工退休金條例，訂定退休管理辦法，明訂員工退休條件、退休金給付標準、退休申請及退休金給付等事宜。並依照規定按月提撥勞工退休準備金，專戶存儲；適用該條例退休金制度之勞工則按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司注重勞資關係互動，每三個月定期召開勞資會議，致力於勞資雙方理性溝通，提倡人性化管理，透過申訴信箱及正當管道直接反應個人意見。了解員工需求適度調整及改善公司相關管理規定。並遵守相關法令規定，致力於維護員工權益。

（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實：

本公司自成立至今，均維持和諧之勞資關係，故未有因勞資糾紛而造成損失。

六、 資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構

本公司資通安全之權責單位為資訊部，並設置一名資安主管及專業資安人員，負責訂定企業內部資通安全政策、規劃暨執行資通安全防護與資安政策推動與落實，並以「資訊循環」為準則推動安全機制之執行，強化風險管理的應變能力、達成資訊安全政策目標。

本公司每年實施資訊安全稽核管理制度，並由稽核室做內部年度稽核，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

2. 資通安全政策

(1)本公司的各項資通安全管理規定必須遵守政府相關法規之規定。

(2)成立資通安全管理專職單位，負責資通安全制度之建立及推動事宜。

(3)定期實施資通安全教育訓練，宣導資通安全政策及相關實施規定。

(4)建立個人電腦、伺服器與網路使用之管理機制。

(5)新系統及設備建置上線前，須將風險、安全因素納入考量，防範危害資通安全之情況發生。

(6)明確規範網路系統之使用權限，防止未經授權之存取動作。

(7)訂定資通安全管理制度內部稽核計畫，定期檢視資通安全管理制度範圍內所有人員及設備使用情形，依稽核報告擬訂及執行矯正預防措施。

(8)訂定營運持續管理備援/備份還原之演練，確保公司業務持續運作。

(9)本公司所有人員負有維持資通安全之責任，且應遵守公司相關之資通安全管理規範。

(10)委外廠商在執行本公司委外業務時若有複委託之需求，應評估複委託業務相關之資安風險。並要求委外廠商依資通安全相關規定對複委託廠商進行適當之監督與管理。

(11)對內部及外部專案管理的過程中，應明訂及陳述與專案相關之各項資通安全要求，確保內部及外部專案資訊之機密性、完整性及可用性，降低機敏資訊外洩及違反法令之風險。

3. 具體管理方案

(1)制度規範：本公司內部訂定多項資安規範與制度，以規範本公司人員資訊安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整。

(2)系統防護：本公司為防範各種內/外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。

(3)人員訓練：本公司定期實施新進人員資通安全教育訓練實務課程，並不定

期實施資通安全機會宣導，藉以提昇公司同仁資安知識與專業技能。

4. 投入資通安全管理之資源

本公司資通安全主旨係在於保護資訊資產之機密性、完整性與可用性，進而確保並提供資訊處理作業能安全有效地運作，並提升資訊服務之信心，在資訊安全的考量下提供最完整的服務，並由資訊部門專責，依照資訊安全政策相關管理辦法進行系統化監控，定期進行資料備份及災害演練、員工資安教育訓練及宣導、招開資安檢討及改善會議，以確保達成資訊安全之要求。

(二) 列明最近二年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、 重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃合約	高淑惠	115/03/01~117/02/29	房屋租賃契約書-高雄	無
租賃合約	黃恒彥、黃偉銘、黃偉哲、紀凌逸、紀塵逸	113/09/01~117/08/31	房屋租賃契約書(含工廠頂樓、停車場)	無
租賃合約	三和塑膠工業	114/01/01~116/12/31	房屋租賃契約書	無
租賃合約	龍舜精密	114/11/01~115/04/30	房屋租賃契約書	無
租賃合約	誠士建設	114/03/01~119/09/28	房屋租賃契約書	無
租賃合約	誠士建設	114/12/01~119/11/31	房屋租賃契約書	無
租賃合約	曾政傑	114/12/01~116/11/30	房屋租賃契約書	無
融資合約	新光銀行	114/09/12~119/09/12	中期擔保放款	無
投資協議	Technoprobe	114/01/17~	Investment Agreement	一般財務性承諾條款
投資協議	YQ Technology	114/01/17~	Investment Agreement	一般財務性承諾條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、 財務狀況

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	728,130	1,267,473	539,343	74.07
不動產、廠房及設備	130,145	404,539	274,394	210.84
無形資產	1,276	2,499	1,223	95.85
其他資產	28,965	68,083	39,118	135.05
資產總額	888,516	1,742,594	854,078	96.12
流動負債	248,201	352,729	104,528	42.11
非流動負債	13,280	197,950	184,670	1,390.59
負債總額	261,481	550,679	289,198	110.60
股本	348,094	366,859	18,765	5.39
資本公積	129,031	501,694	372,663	288.82
保留盈餘	149,887	323,138	173,251	115.59
其他權益	23	224	201	873.91
歸屬於母公司業主之權益	627,035	1,191,915	564,880	90.09
權益總額	627,035	1,191,915	564,880	90.09

1. 變動原因說明：(變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)

   流動資產：主要係因本期營運狀況良好，現金及約當現金、到期日超過三個月之定期存款、應收款項及存貨等隨之增加所致。

   不動產、廠房及設備：主要係因本期購置土地及廠房所致。

   其他資產：主要係因租賃新辦公室及廠房，致使用權資產增加所致。

   流動負債：主要係因營運擴張，相關應付款項增加，以及本期獲利良好，致估列之員工及董事酬勞增加所致。

   非流動負債：主要係因本期舉借長期借款所致。

   資本公積、保留盈餘、歸屬於母公司業主之權益及權益總額：主要係因本期獲利增加所致。

2.未來因應計劃：上述變動對本公司財務、業務並無重大不利影響，故無需擬定因應計畫。

二、 財務績效

(一) 經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年度	114 年度	增（減）金額	變動比例（%）
營業收入淨額	406,017	716,233	310,216	76.40
營業成本	80,150	170,092	89,942	112.22
營業毛利	325,867	546,141	220,274	67.60
營業費用	175,359	267,816	92,457	52.72
營業淨利	150,508	278,325	127,817	84.92
營業外收入及支出	16,607	(1,303)	(17,910)	(107.85)
稅前(淨損)淨利	167,115	277,022	109,907	65.77
所得稅利益(費用)	(17,228)	(49,351)	(32,123)	186.46
本期(淨損)淨利	149,887	227,671	77,784	51.90
本期綜合損益總額	149,976	227,872	77,896	51.94
淨利歸屬於母公司業主	149,887	227,671	77,784	51.90
綜合損益總額歸屬於母公司業主	149,976	227,872	77,896	51.94

1.變動原因說明：(變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)

(1)營業收入、營業成本、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益、淨利歸屬於母公司業主及綜合損益總額歸屬於母公司業主：主要係因本期客戶需求增加，訂單量增加，故營業收入增加所致。

(2)營業費用：主要係因本期營業收入增加，估列員工酬勞增加所致。

(3)營業外收入及支出：主要係因外幣兌換損失增加所致。

(4)所得稅費用：主要係因本年度營業收入增加，估列相關所得稅費用所致。

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫未來因應計劃：因本公司未編制及公告財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據之評估；另本公司財務尚屬健全，應無資金不足之情事，且整體營運表現尚無重大異常，亦無需擬定因應計畫。

(二) 營業毛利變動分析表

單位：新台幣仟元

	營業收入淨額	營業成本	營業毛利	毛利率 (%)
113 年度	406,017	80,150	325,867	80.26
114 年度	716,233	170,092	546,141	76.25

增減變動達20%以上之分析說明：

毛利率變動未達20%，故不予分析。

(三) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫請參閱本年報第 1~2 頁致股東報告書之說明。

三、 現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣仟元

項目	113 年度	114 年度	差異	
			金額	比率%
營業活動之淨現金流入(出)	279,492	(82,045)	(361,537)	(129.36)
投資活動之淨現金流入(出)	(111,818)	(454,110)	(342,292)	306.12
籌資活動之淨現金流入(出)	70,816	486,755	415,939	587.35
增減變動達 20%以上之分析說明： 1.營業活動現金流入減少：主係因本年度應收帳款增加，以及因購置廠房後進行整建，致相關預付工程款增加所致。 2.投資活動現金流出增加：主係因本年度購置土地及廠房，以及逾三個月之銀行定期存款增加所致。 3.籌資活動現金流入增加：主要因本年度舉借長期借款所致。				

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年投資及籌資活動淨現金量(3)	預計現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
403,022(註 1)	(272,054)	2,087,234	2,218,202	—	—
1.未來一年現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係營收成長，購料及備料支出與人力成本相應增加。 (2)投資及籌資活動：主係發放現金股利、辦理上櫃掛牌前現金增資及購置產線所需相關機器設備等。 2.現金不足額之補救措施：無預計現金不足額之情形，故不適用。					

註 1：期初現金餘額未含按攤銷後成本衡量之金融資產。

四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策：

本公司對轉投資事業之管理及控制目前訂有內部控制制度「投資循環」、「取得或處分資產處理程序」，以便掌握轉投資事業之財務、業務狀況；另訂定「對子公司監督與管理辦法」相關規範，以便督促各子公司針對重大財務、業務事項訂定相關作業程序，並監督其依法執行或辦理，建立子公司營運風險管理機制，以發揮最大之經營績效。

(二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

單位：新臺幣仟元

關係企業名稱	持股比率	114 年度認列投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Vision Wealth Global Co., Ltd	100%	6,614	係認列轉投資公司投資利益所致	-
上海創崴醫療器械有限公司	100%	6,614	業務持續拓展所致	-

(三) 未來一年投資計畫：無，本公司將以長期策略性投資審慎評估投資計畫。

六、 風險事項之分析評估

(一) 最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動影響

本公司 113 及 114 年度之利息費用分別為 76 千元及 1,239 千元，占營業收入淨額分別為 0.02%及 0.17%，比例甚微，上開之利息費用主係租賃產生之押金設算息。本公司於 114 年 8 月購入大甲區光明段土地及廠房，114 年 9 月始向銀行辦理融資借款，目前營運資金尚屬充足，負債比例不高、利息支出占營業收入比重尚低，故利率變動對本公司損益尚不致有重大影響。本公司時時觀察金融市場發展情勢，注意利率變動情形，並與往來銀行保持良好連繫。

2. 匯率變動

本公司 113 及 114 年度之兌換(損)益分別為 5,873 千元及(15,318)千元，占營業收入淨額分別為 1.45%及(2.14)%。本公司於外幣資金管理及外匯避險政策以保守穩健為原則，對於國外銷售及採購交易均以外幣報價，使外幣收支互抵產生自然避險效果。財務部門密切注意匯率之變動，並適時調控外匯持有水位及兌換時機，降低匯率變動對公司損益之影響。

3. 通貨膨脹

本公司最近年度及截至年報刊印日止之損益，並未因有通貨膨脹而產生重大影響之情事。本公司會評估考量因通貨膨脹而提高的生產成本，隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係並協商報價，以降低通貨膨脹對公司營運及獲利產生影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注於本業，秉持保守穩健之經營原則，截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資。若從事各項投資及衍生性金融商品交易等將依本公司訂定之相關作業辦法辦理。本公司已訂定「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「取得或處分資產管理辦法」等辦法，做為本公司之遵循依據。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 研發計畫

本公司已獲國際半導體晶圓測試微機電垂直式探針卡(Vertical MEMS Probe Card)大廠策略投資，正式成為其集團戰略重要合作夥伴，將在 MEMS 探針卡商務共同合作，目標在台灣及中國探針卡市場擴大銷售，並利用公司多年來於 MEMS 探針卡積累之技術與自動化設備開發優勢，專注研發新世代 MEMS 探針卡全自動化製造、檢測及返修設備，並投入建置全自動化維修產線以跨入探針卡全自動化返修代工業務，協助大幅縮短高階探針卡維護與返修 lead time，進而加速擴大市佔率與提升產品競爭力。

本公司研發計畫皆以符合客戶專業專項需求為主，近年度研發計畫中已成功開發多項半導體晶圓測試探針卡、IC FT 終端測試 Pogo Pin 之相關先進自動化設備。尤以 114 年度成功量產並推出 Dual Arm MEMS 探針卡自動植針設備以及整線探針卡自動返修設備、多款先進精密組裝設備以及先進封裝銅柱端子模組產品等。

為持續強化未來在 MEMS 探針卡，先進封裝銅柱端子模組以及高精密自動化設備等三大核心領域之競爭優勢，公司將持續投入研發與創新，除了自動化設備產品線外，更開始邁向探針卡整卡銷售、建置自動化維修產線已開啟代工商務以及推出更先進之銅柱模組及銅柱移植玻璃通孔基板 TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)，未來預估進行之重要研發計畫將落實以上全線自動化之技術與設備投入，說明如下：

研發計畫 名稱	關鍵 技術	目前 進度	預計 量產時程
MEMS 探針卡 自動化返修產線	■自製專用全自動化相關返修檢測設備	開發建置中	2026 年 Q2
銅柱端子模組自動化量產線	■自製專用全自動化銅柱模組生產線 ■微間距全自動化銅柱微整列&移轉技術 ■精密自動化補針技術 ■精密 AI AOI 辨識及 Laser 掃檢量測技術	建置中	2026 Q4
TGV-ICP (Through Glass Via-Inserted Cu Pillar)銅柱玻璃通孔基板	■微間距高寬深比(>1:10)巨量移轉銅柱技術 ■微銅柱自動精密補 Pin 技術 ■精密 AOI 視覺辨識及量測技術 ■銅柱 TGV 自動膠填封裝技術	開發驗證中	2027 年 Q4

2. 預計投入之研發費用

預計 115 年度投入研發之費用將不低於以前年度之研發費用水平，以因應半導體晶圓測試市場垂直式 MEMS 探針卡的大量需求以及銅柱端子模組終端市場客戶的量產導入，公司將投入之研發費用依新產品及技術開發進度編列，除研發

自有生產及維修設備，將持續擴大招募有能力之探針卡相關及先進封裝之研發及技術應用人才，以提升研發與售服能力，因應新的市場開拓及確保核心競爭優勢。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法規變動情形，評估其對公司之影響，提供管理階層相關決策所需，以充分掌握並因應市場環境變化。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意產業相關技術發展變化趨勢及掌握市場動向，評估其對公司營運所帶來之影響，並投入研發經費與人力從事研發關鍵核心技術、提升量產品質及降低生產成本等措施因應。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到科技改變及產業變化而有影響財務業務之情事。

本公司為因應日益升高的資安風險，本公司已設置一名資訊安全專責主管及一名資安人員，並由資訊部門為資訊安全主理單位，負責訂定與實施資訊安全管理辦法，來降低勒索病毒的攻擊與資安事件發生的風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，秉持著穩健誠信之經營宗旨，積極強化內部管理與保持和諧勞資關係，以建立優良之企業形象，且規劃朝資本市場發展後，即可吸引更多優秀人才進入本公司服務，以厚植經營團隊實力，對本公司形象將有相當正面之助益。為有效監督組織活動，健全組織運作，藉以防止經營之弊端，已擬訂具體組織制度及規章，使本公司在符合公司治理精神下穩定經營及成長。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，尚無併購他公司之計畫，惟將來若有併購計畫時，本公司將依「取得或處分資產處理程序」辦理，並審慎評估考量合併是否會為本公司帶來具體效益，以確保公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司相關投資規劃均依「取得或處分資產管理辦法」審慎評估以降低可能風險；民國 114 年 8 月 6 日董事會已通過大甲區土地廠房購置案，新廠建設採分階段規劃與施工。原地上既有廠房修繕整改預計於 115 年第一季完工，以確保現有設備生產製造產能順利移轉至新廠，並即時滿足現階段客戶需求產能；第二棟建物擬於 115 年元月份動工興建，預計 116 年第二季底完工。整體而言，取得自有資產可降低租賃依賴與減少租金支出；擴廠可保留中長期擴充空間，支援新產品與客戶導入的業務需求。惟仍存在工期若延宕，恐無法配合客戶拉貨時程，導致產能消化不及等風險。本公司已採取分階段投產、事前完成合規設計審查以確保消防、電力一次到位驗證，並依客戶專案時程倒排產能配置、設定產能 KPI 與預警門檻等措

施；綜合評估，前述風險可控，最近年度及截至年報刊印日止，未對公司營運造成重大不利影響。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險

半導體精密自動化設備主要關鍵原材料為精密伺服驅動馬達系統、人機協作自動控制系統以及精密工業視覺元件模組系統等材料，本公司透過嚴格審核與評選制度，優先以品質、可靠度、穩定度及工安為考量，進貨項目皆建立至少兩家以上之長期合作之合格供應商，同時透過定期稽核制度審查合格供應商績效，依據市場供貨狀態及訂單需求調整進貨比例，以降低供貨短缺或中斷之風險，故未有仰賴單一供應商之情事。另，本公司於114 年與國際探針卡大廠策略合作並取得該公司台灣及中國區之探針卡材料包及其專用植針設備之銷售權，由於交易設備之單價較高，故 114 年度向該公司進貨占當期進貨金額超過 30%，此為本公司增加探針卡材料包及探針卡維修收入之佈局考量，進貨集中風險應屬有限。

2. 銷貨集中風險

半導體產業擁有技術不斷創新及市場高度寡占的產業特性，本公司 114 年度主要客戶為國際 MEMS 探針卡大廠，且受惠 AI 晶片需求爆發帶動市場快速成長，致最近二年度及 114 年前三季皆有單一客戶銷售比重超過 30%之情事。本公司一方面同步推進探針卡材料包於大中華市場之銷售，以建立穩定之經常性收入；另一方面延伸技術佈局聚焦於開發其他利基型產品（如其他半導體自動化檢修設備）及銅柱巨量移轉模組，其中銅柱巨量移轉模組之研發與商業化將透過試產線導入、關鍵製程模組建立與客戶驗證，切入先進封裝應用市場，以分散營收結構、降低銷貨集中風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變而對公司產生重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、 其他重要事項：

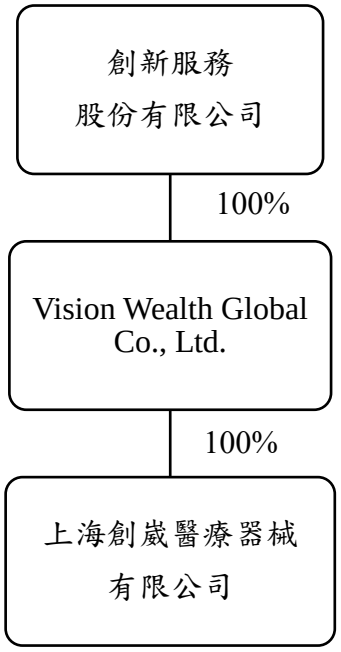
無。

陸、特別記載事項

一、最近年度關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖

日期：114 年 12 月 31 日



(二) 各關係企業基本資料

114 年 12 月 31 日；單位：股；%；新臺幣仟元

關係企業名稱	與本公司之關係	本公司直接或間接持有			持有本公司股份		
		股數	持股比例	實際投資金額	股數	持股比例	實際投資金額
Vision Wealth Global Co., Ltd.	子公司	289	100	8,891	—	—	—
上海創崴醫療器械有限公司	孫公司	註	100	8,891	—	—	—

註：非為股份有限公司，故無股數

(三) 推定為有控制或從屬關係者其相同股東資料：無。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

關係企業名稱	主要營業項目
Vision Wealth Global Co., Ltd.	投資控股業務
上海創崴醫療器械有限公司	電子功能性材料買賣

(五) 各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

單位：仟股，%；114 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Vision Wealth Global Co., Ltd.	董 事	吳智孟	0	0
上海創崴醫療器械有限公司	董 事	吳智孟	0	0

(六) 各關係企業營運概況

單位：新臺幣千元；114 年 12 月 31 日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業損益	本期損益(稅後)
Vision Wealth Global Co., Ltd.	8,891	3,496	0	3,496	0	0	6,614
上海創崴醫療器械有限公司	8,891	3,496	1,295	2,201	13,460	6,948	6,614

(七) 關係企業合併財務報表

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報所表應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(八) 關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價券辦理情形：無此情事。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

創新服務股份有限公司

董事長：吳智孟